



240,000M² 展出面积
100,000+ 专业观众
3,000+ 参展企业

产品采购指南

半导体

第24届中国国际光电博览会

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)



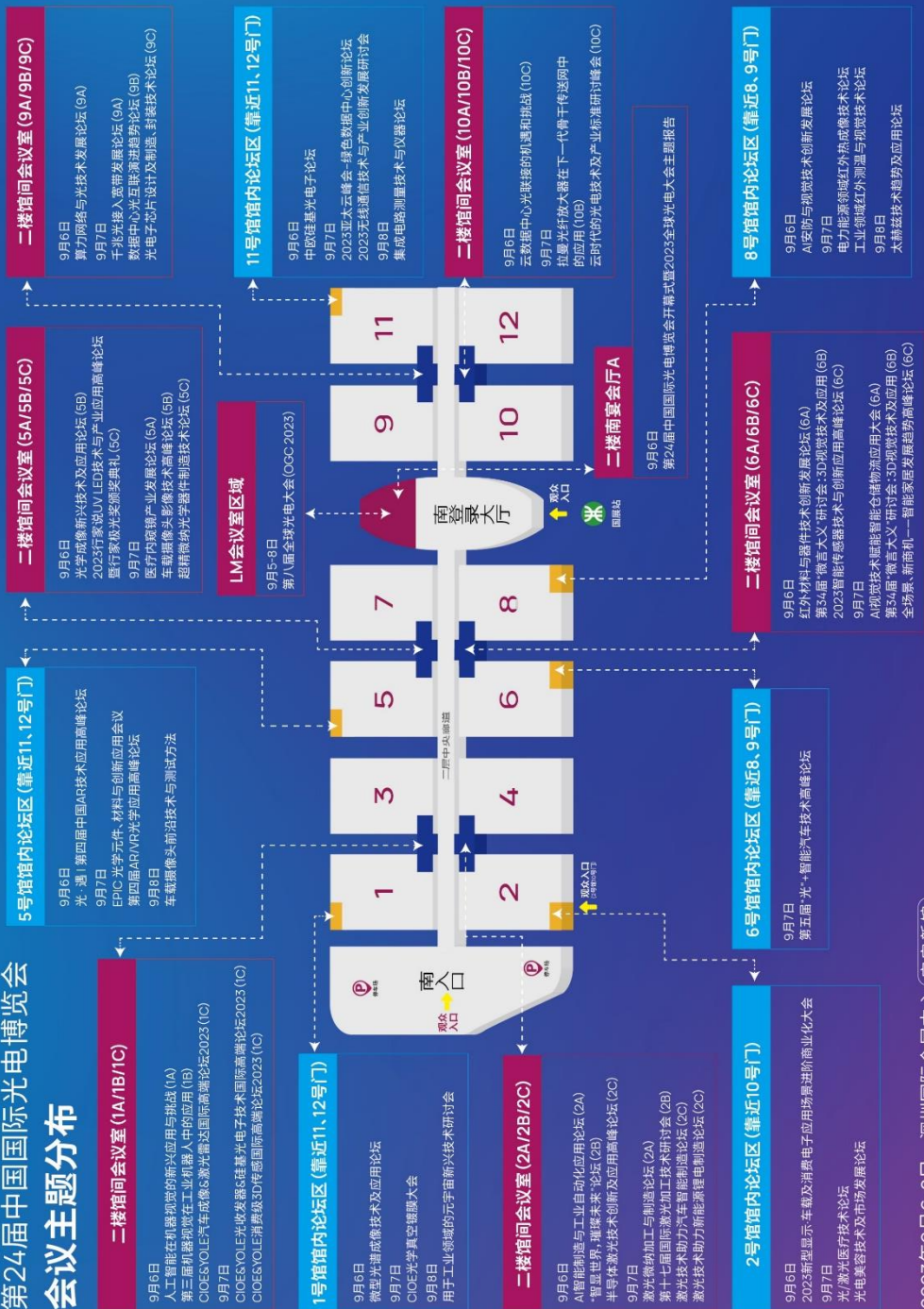
扫码登记免费参观

100



扫码查看会议详细议程。

第24届中国国际光电博览会 会议主题分布



*所有会议安排请以现场实际为准。

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心 宝安新馆

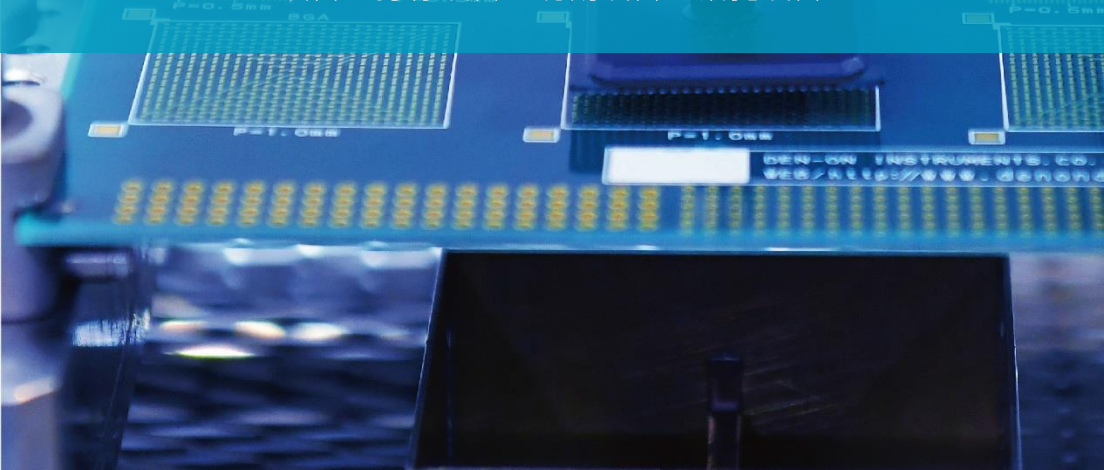
产品类型	同期展会	页码
半导体设备		
光刻技术/光刻机	光电子创新展/传感展/精密光学展/激光及智能制造展	7-8
耦合机	信息通信展/激光及智能制造展	9-10
键合机	信息通信展/激光及智能制造展/红外展	11
固晶机	信息通信展	12
试验机 / 芯片测试机	信息通信展	13
贴片机	信息通信展	14
减薄机 / 贴装装备	信息通信展/精密光学展/光电子创新展	15
显示装备	新型显示展	16
测量仪	信息通信展/精密光学展/智能传感展	17
抛光机	精密光学展/光电子创新展	18
研磨机	精密光学展/激光及智能制造展/信息通信展	19
轮廓仪	精密光学展	20
真空镀膜设备	精密光学展/新型显示展	21
探针台	激光及智能制造展/传感展/光电子创新展/信息通信展	22
清洗机	精密光学展/信息通信展/激光及智能制造展	23
固化设备	精密光学展/信息通信展	24
划片机	精密光学展/信息通信展/激光及智能制造展	25
检测设备	激光及智能制造展/信息通信展	26
光谱仪	激光及智能制造展/精密光学展	27
蚀刻机 / 等离子去胶机	精密光学展/信息通信展	28
焊接设备	激光及智能制造展/信息通信	29
打标设备	激光及智能制造展/信息通信	30
切割设备	激光及智能制造展/信息通信/精密光学展	31
钻孔设备	激光及智能制造展/精密光学展	32

产品类型	同期展会	页码
半导体材料		
晶圆	光电子创新展/精密光学展/红外展	34
陶瓷	信息通信展/精密光学展/激光及智能制造展	35
靶材 / UV减粘膜	精密光学展/新型显示展/信息通信展	36
抛光液	精密光学展/红外展	37
砂轮	精密光学展/激光及智能制造展/信息通信展	38
研磨材料	精密光学展/信息通信展	39
基板	光电子创新展/激光及智能制造展	40
光刻胶	光电子创新展/新型显示展/激光及智能制造展/精密光学展	41
模具材料 / 焊料	精密光学展/信息通信展	42
光电子芯片		
光芯片	信息通信展	44-47
电芯片	信息通信展	48-50
VCSEL / 激光芯片	信息通信展/激光及智能制造展/智能传感展/红外展	51-53
传感器芯片	智能传感展/光电子创新展	54-55
传感器		
MEMS传感器	智能传感展/红外展	57
3D视觉/图像传感器	智能传感展	58-59
工业传感器	智能传感展	60
传感器	智能传感展	61



重点展示半导体设备

展示范围：光刻技术/光刻机、耦合机、键合机、固晶机、试验机、芯片测试机、贴片机、减薄机、贴装装备、显示装备、测量仪、抛光机、研磨机、轮廓仪、真空镀膜设备、探针台、清洗机、固化设备、划片机、检测设备、光谱仪、蚀刻机、等离子去胶机、焊接设备、打标设备、切割设备、钻孔设备



光刻技术/光刻机

中国科学院光电技术研究所

6A80

紫外光刻机

系列紫外光刻机，包括单面接近接触式光刻机，双面光刻机，大面积光刻机，连续扫描光刻机，无掩模光刻机，步进投影光刻机、纳米压印光刻机等多种光刻机类型，可满足LED，光电探测器，应变片，MEMS，生物芯片，微光学元件，声表器件等多种微纳结构检测需求。



托托科技（苏州）有限公司

6A122

无掩模板紫外光刻机

无掩模光刻设备基于空间光调制器的技术，实现了高速、高精度、高灵活性的紫外光刻。光刻机的分辨率和套刻精度决定了所制造的集成电路的集成度，这是光刻机品质的关键指标。



深圳市蓝星宇电子科技有限公司

6E82

准分子激光器/激光光刻机

准分子激光器/激光光刻机，微纳加工，最小线宽0.3UM。



苏州美图半导体技术有限公司

6B87、6B88

LED紫外光刻机

尺寸：4-8英寸；波长：365nm；分辨率：1μm（胶厚1μm）；对准精度：±2μm（±1μm可选）；单面、双面对准（可选）；程序设置光强；*可根据客户需求定制。



光刻技术/光刻机

北京汇德信科技有限公司

5A08

高分辨紫外/深紫外PHABLE光刻机

EULITHA AG公司开发的PHABLE大面积、低成本的纳米图形化方案，采用突破性的Displacement Talbot Lithography专利技术。相比传统的电子束光刻、投影式光刻机、纳米压印等纳米结构方案中，遇到的生产效率、良率、生产成本等问题，PHABLE光刻技术提供了高精度、高均匀性、低缺陷率、高产率的解决方案。



Stella International Corporation Limited

6A22

DWL多功能专业型灰度光刻机

DWL系列灰度光刻解决方案：高分辨率的激光直写光刻机，拥有多种选配功能；具有快速灵活的高分辨率达到灰度光刻的专业表现，能在厚光阻中创建复杂的2.5D微结构。



四川芯辰光微纳科技有限公司

3E88

接近接触式光刻机

接近接触式光刻机XCG-i600采用i线UVLED曝光光源，光学系统采用自由曲面配光技术，特殊的消衍射和线条陡直增强技术采用大面积复眼透镜实现高均匀照明，并配备了双目CCD图象对准系统，曝光能量高，聚光角度小，兼容厚胶曝光功能，曝光设定采用自主开发程序控制，带触摸屏面板的MCU控制，操作简便，广泛应用于半导体、微电子、微纳米光学、生物器件和纳米科技领域。



玖万（上海）半导体科技有限公司

4D172

大幅面激光直写光刻机

Maximum Exposable Area:1000*1000mm² Light Source: 405nm GaN Laser Diode Maximum Write Speed:280mm²/min Minimum Feature Size:600nm



耦合机

镭神技术（深圳）有限公司

10C75

自动光路耦合机

耦合机，主要的耦合轴高精度的全闭环运动平台能满足不同产品的需求。采用高精度图像辅助定位系统能消除来料物料差异，提高耦合的速度，同时避免了因来料物料差异过大导致物料与物料之间碰撞损坏产品的风险，并更适合大规模的生产；拥有自动校准定位相机与吸嘴及定位相机与针嘴的功能，降低了调校工程师要求，提高人性化的调校方法，同时规避了一些调校时发生碰撞的风险；在准直镜吸嘴上拥有压力反馈系统能测量准直镜底面与基板上表面的距离，同时规避了损坏准直镜或基板的风险。



半
导
体
设
备

骏河精机科技（上海）有限公司

10C31

波导耦合（被动元件耦合）系统

通过为耦合系统专用开发的滑台组合与软件。配合客户的装置，为您提供最适合装置的建议。高速耦合独创算法实现高速化操作性提升。通过对话型介面，提升软件操作性。除此之外，骏河可以根据客户的多样化需求提供个性化的定制解决方案，特别在高精度的组装和测试领域，骏河具有多年的丰富经验和精湛技术，将全力助力于实现工业4.0目标。



武汉来勒光电科技有限公司

4A015

蝶形激光器自动耦合系统

蝶形激光器自动耦合系统是武汉来勒光电科技有限公司自主研发的一款基于蝶形封装器件的自动耦合设备。用于光纤穿入到蝶形封装外壳内部进行耦合的一种自动耦合设备，很好的解决了光纤准确穿插、柔性夹持和高效耦合等难题。



武汉红星杨科技有限公司

4D020

耦合对准系统

耦合对准系统包含自动耦合系统、手动耦合系统，耦合位移台，耦合夹具器件。



耦合机

东莞市耀野自动化有限公司

10C26

透镜耦合机

用于各种高精度透镜（LENS）耦合，XYZ三轴由直线电机+光栅尺组成，分辨率5纳米，重复定位精度20纳米。自动拾取透镜，自动耦合，自动点胶，自动分段UV固化。具备全自动视觉定位，真空机械二合一透镜夹，均为行业先进水平。有伺服电机版的低成本方案供选择。



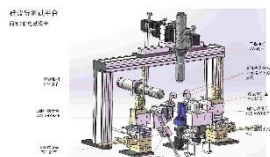
半导体设备

上海摩本电子科技有限公司

11B908

硅波导耦合系统

适用于科研和生产的高性能芯片与光纤自动耦合对准系统。采用模块化设计，方便用户根据需求进行升级和更新。可适用于Si、InP、SiO₂、铌酸锂等多种材料波导测试。友好、灵活的人机界面易于使用，用户通过简单的培训即可操作。可进行芯片端面耦合、芯片光栅耦合、晶圆级光栅耦合测试等。



湖南中南鸿思自动化科技有限公司

10D25

FAC自动耦合封装设备

设备功能：用于半导体激光器泵浦源中快轴准直透镜的自动耦合封装。可实现FAC透镜的自动拾取、姿态调整、光斑耦合、精确点胶以及UV固化。采用高速高精度直线电机，具有高工作节拍与效率。

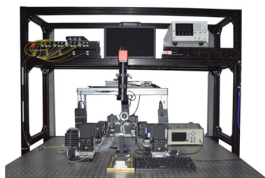


深圳光泰通信设备有限公司

10A79

AWG & PLC波导芯片耦合系统

1、半自动六维电动直线轴和六维手动旋转轴进行控制，全自动十二维电动轴，特殊算法快速找到最佳信号位置。 2、兼容石英玻璃基和硅基芯片材料，兼容平行和垂直方式耦合。 3、流程化操作，具有调平衡功能，兼容各种类型的AWG/PLC产品耦合。 4、自动找光时间<15秒，耦合重复性<0.1dB。 5、压力传感器自动控制胶层距离（精度2μm），保证重复性和一致性。 6、自动点胶，自动UV，耦合异常自动报警等先进的耦合功能。



键合机

SET CORPORATION SA

8C09、8C10

ACCμRA100/OPTO

ACCμRA100/OPTO是半自动倒装芯片键合机，设计用于键合后精度为0.5 μm。ACCμRA100/OPTO兼具高精度，可访问性和成本效益。它的灵活性使其非常适合开发广泛的应用程序。它是大学和研发机构的理想设备。



半导体设备

苏州芯图半导体有限公司

10E039

全自动临时键合机

苏州芯图半导体有限公司位于苏州市工业园区纳米城，作为半导体设备服务商，以代理服务为起点，协同兄弟公司实现半导体设备国产化。公司业务包含自主研发生产、代理国内外半导体主设备、耗材买卖等服务，产品应用领域包含LED、激光、功率、射频、先进封装及半导体等。苏州芯图兄弟公司-苏州芯睿科技有限公司、苏州芯默科技有限公司成立于2021年，自主研发生产临时键合解键合设备，高温快速退火炉，包含其高度精密零配件，均有自主研发技术。



中山市新微细线电子有限公司

10C57

引线键合机

IBond 5000键合机功能多样，可用于制程开发、生产、科研，并可对制造过程提供更多的支持；支持混合电路，MCM多芯片模块、COB板装芯片、光学器件、微波器件、传感器、大功率产品、激光器件及分立器件等多种产品应用。



北京华奥复兴科技有限公司

2A052、2A053

多功能键合机

多功能键合机是一款用于芯片和基板之间电气互联和芯片间的信息互通的手动键合设备，该设备基于超声键合原理，通过精密的机械结构和高度集成的硬件软件控制，实现引线与基板焊盘的紧密连接，设备具有球焊和楔焊两种功能，可用于金丝、铂金丝、铜丝、银丝、铝丝、金带等多种类型引线的键合，广泛适用于半导体器件的实验室研发、产品原型试产、产品评估、产品返修等。



固晶机

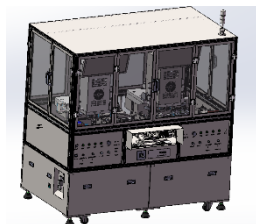
江苏佑光科技股份有限公司

10B75

DB610双头miniLED高速固晶机

双头miniLED直显固晶机，双头四臂同时固晶2片PCB板，具体规格：

1.固晶精度：±15um；2. 固晶角度：±1°；3.UPH=70K；4. 晶环尺寸：6 inch（子母环）数量：12pcs；5. 进出料方式：PCB板左进右出，晶环自动换环（双边）。



微见智能封装技术（深圳）有限公司

10B69

多功能高精度固晶机MV-15D

微见智能MV-15D同时具备共晶，蘸胶，点胶，UV等工艺能力，支持蓝膜，Gel pack/waffle pack，轨道等上下料方式，支持多芯片应用，可自动更换大于13个不同类型的吸嘴。灵活的应用软件系统支持不同产品应用，工艺应用自由切换，不需要额外的软硬件校验。兼容COC/COS，COB，BOX等各种封装形式。该设备可广泛应用于光通信、激光雷达、5G 射频、商业激光器等多个领域，是芯片封装过程中不可或缺的工艺设备。



东莞市耀野自动化有限公司

10C26

高精度固晶机（3微米）

固晶精度3微米(3Sigma)，兼容点胶和共晶工艺，兼容晶圆环和料盒，可以同时安装6个晶圆。

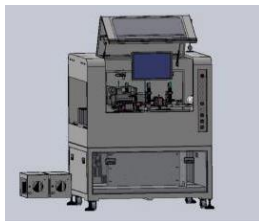


深圳市大成自动化设备有限公司

10A13

高精度固晶机

三视觉TO固晶机是一款用于光通信封装行业的专用设备，可把阵列方式排列附设于蓝膜上的管芯直接固定到管座指定位置上。主要机构为取晶视觉校正移动式直线马达工作台，固晶视觉校正移动式旋转直线马达工作台，晶环上下料机构，管座模块上下料机构，点胶机构，取晶升降摆臂及顶针机构。主要功能，全自动上下料，能够自动吸取放置在取晶工作台上的管芯，通过固晶旋转伺服马达，调整角度使管芯准确固定在管座上。该设备采用二次视觉校正，排布精准，速度响应快，运行可靠，自动化程度高，可一人多机操作，能够节省人工工时及人工成本。



试验机 / 芯片测试机

广东莱伯通试验设备有限公司

10A28

综合环境试验机

我们一直关注可靠性试验技术的最新发展,非常重视提高可靠性试验设备技术。“环境仿真”的要求也使客户认识到由一家供应商提供振动台和试验箱以实现完整综合试验的重要性.我们可以依据客户不同的试验需求,提供范围广阔的综合环境试验系统,如三综合、四综合试验设备方案、多轴振动试验系统和最新试验技术。



半
导
体
设
备

海拓仪器（江苏）有限公司

10C32

加速寿命试验机（HAST）

HAST加速寿命试验装置能够评估电子元器件、PCB、芯片产品等在高温,高湿,高压条件下对环境的抵抗能力,通过加速其失效过程,加速因子在几十到几百倍之间,此类极端的加速模拟可靠性测试,便于确定产品或器件的极限工作条件,更容易提前发现产品失效模式,并目缩短产品或系统的寿命试验时间,为量产验证赢得时间。



河北圣昊光电科技有限公司

10D51

LD芯片测试机

LD芯片测试机用于对LD芯片的电气和光学特性进行检测、判定与分选。主要包含DFB芯片低温/高速双温测试机、DFB芯片高频特性测试机、EML芯片测试机、COC特性测试机和大功率芯片测试机。该系列产品具有测试速度快、温控精度高,测试数据的再现性和相关性稳定可靠、数据准确等优点。发散角测试(选配):快轴发散角 测试范围:±60° 慢轴发散角 测试范围:±60° 分辨率:0.072°。电机驱动测试模式: (1) 普通LD (DFB) 模式 (2) LD+EA模式 (3) LD+SOA模式 (4) LD+EA。



深圳互喜智联科技有限公司

10D65

半导体激光器COS测试设备

LD-COS检测设备 用于激光芯片贴片后,光性能的检测设备。传统检测方式为人工上下料,仪器检测数据,人工筛选和记录。本设备将全面实现自动化,大大提高芯片检出效率,减少人为操作带来的误判或芯片损伤,更省人省时。技术参数: 功率的测试范围: 0-50W 波长检测测量范围: 300-1050nm 波长测量精度: 1nm 偏振度差值: ≤±0.5% 设备基本功能: 大小热沉、二维码录入、OCR识别、自动上下料、测试温度可控、双工位4治具、加电探针可调压、自动识别。



贴片机

MRSI (Mycronic Group)

10B79

MRSI-M3 3微米贴片机

MRSI-M3 3微米贴片机，为大批量生产环境下的超高精度、高复杂性芯片贴装树立了标杆。MRSI-M3 贴片机通过贴片压力控制、超高精度贴放以及360°芯片定向等特性，确保了先进封装过程中的高良率、高质量和高可靠性。



江苏佑光科技股份有限公司

10B75

DB805A高精度环氧贴片机

高速环氧贴片机配置2个贴片模组，2个蘸胶模组，6个Wafer供料系统，通过取料吸嘴从Wafer取料，放中转台，校准后，贴片吸嘴从中转台吸取芯片，视觉识别后贴装到指定位置。用标准玻璃片进行测试30次，计算Sigma，要求 $3\sigma \leq 5\mu\text{m}$ ， $Cpk \geq 1.33$ （贴片公差按照 $\pm 5\mu\text{m}$ 计算）；用COB产品贴装30次，计算Sigma，要求 $3\sigma \leq 7\mu\text{m}$ ， $Cpk \geq 1.33$ （贴片公差按照 $\pm 7\mu\text{m}$ 计算）；贴片压力： $20-250\text{g} \pm 10\%$ ；贴片效率：UPH ≥ 800 芯片；



深圳市锐博自动化设备有限公司

10C71

自动点胶贴片机 DB-560P

DB-560P是COB/COC制程中将基底(PCB或其他待加工材料)与芯片，经过点胶工艺键合的生产设备。



翼龙半导体设备（无锡）有限公司

10C29

全自动多功能贴片机

- 1.系统微组装机封装设备
- 2.主要适用封装类型：光通讯/SIP/射频模组/高精度大芯片倒装
- 3.可根据客户需求提供定制化封装设备



减薄机 / 贴装装备

北京特思迪半导体设备有限公司

6C98

全自动减薄机 (TFG-3200)

TFG-3200是一款操作简单、功能丰富的高精度研磨设备，设备配置自动厚度测量和补偿系统，通过驱动减薄砂轮高速旋转，自动研磨晶圆至目标精度，工作台可定制，兼顾多尺寸晶圆，设备应用广泛。全自动系：全自动上下片，干进干出的全自动研磨系统 功能全面：自动厚度测量 多段研磨程序 超负载等待 兼容性好：可磨削各类半导体材料 兼容6&8英寸晶圆减薄 配置丰富：双轴研磨单元 三工作台加工。



半导体设备

苏州博宏源机械制造有限公司

3C21

减薄机

主要用于硅、锗、石英、砷化镓、陶瓷、蓝宝石、碳化硅等硬脆材料的精密减薄，也适用于集成电路、分离器件、LED芯片等的背面减薄。通过使用细目磨轮可直接对蚀刻表面和抛光表面实施研磨加工，减小晶片之间的厚度偏差，提高晶片内的TTV(平面度)。 1、采用触摸界面及PLC控制，开放式的图形操控界面，充分发挥机械硬件性能； 2、具有在线测量功能，重复精度±0.5um； 3、有单头、双头等多款设备； 4、可选配MES通讯单元，可实现加工工艺数据的抛转及上传下发。



恩纳基智能科技有限公司

10D31

T18高精度智能贴装装备

应用领域：适用于光模块VCSEL、TIA、PD、MPD等芯片类高精度固晶硬件配置 1、设备最高精度达±3 μm@3σ，配置高精度校准平台及底部相机，芯片外观检测功能，芯片位置及角度校正功能 2、具备双工作平台，采用点、画、蘸胶独立控制系统，胶量控制更加精确可靠，可根据客户需求定制 3、通用式自动上下料平台、适用于不同类型的Wafer、Tray等定制类型料盘 4、采用音圈电机可自动校正焊头、确保贴片过程中力控的稳定性 软件功能 1、高精度芯片搜索平台、自动扩晶系统 2、采用多款配置



北京创世杰科技发展有限公司

10B77

全自动高精度多功能贴装系统

T-8000-G贴装系统是一款全自动、多功能、高精度、高效率的贴装设备。该设备主体采用大理石框架结构，大尺寸贴装区域700 X 500 mm 支持自定义区块划分及夹具配置；支持2" -12" 晶圆拾取；X和Y轴使用线性马达驱动设计，采用精度为 0.1μm 的线性光栅编码器，使得它在总体复合精度高达2.5μm@3sigma同时拥有了较快响应速度；压力范围从15g到800g(可选15g到5Kg)。该设备拥有众多可选配置。



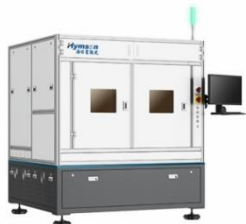
显示装备

海目星激光科技集团股份有限公司

2B060

Mini LED 巨量焊接设备

本设备用于Mini LED整板芯片高质量焊接工艺,可取代传统工艺的回流焊,兼容Mini LED直显模组、背光板以及COB封装、MIP封装等多种产品。设备特点:设备占地面积小、能耗低、无需氮气,能协助企业实现全自动化生产从而降低生产成本。搭配高精度实时测温系统实现精密温控焊接,避免温度震荡对产品的热伤害。搭配高精密压合结构,有效控制芯片倾斜角度及芯片偏移,解决传统麻点问题。设备生产良率明显优于传统回流焊设备。产品适应性强,可以分区域拼焊,兼容PCB、玻璃等制程等不同类型的基板。



季华实验室

2B120

超高分辨率OLED发光层像素喷墨打印成套验证装备

200mmX200mm OLED 发光层像素喷墨打印验证装备主要用于对OLED发光层像素喷印工艺、喷孔控制算法、墨路稳定性等进行验证,指导后续OLED 4.5代线发光层像素喷墨打印装备的设计工作。该OLED发光层像素喷墨打印验证装备能够成为OLED喷印行业重要的试验设备,对工艺、墨水材料、供墨系统、喷印控制算法、喷印环境等喷印的重要因素进行测试,能够大幅提升企业的工艺设计效率,同时也能成为从事相关研究的高校及科研院所的试验测试平台,帮助其开展科研探索。



苏州迈为科技股份有限公司

2B100

MX-LMT Micro LED巨量转移设备

该设备用于Micro LED的巨量转移工艺,采用高性能激光器,配合自主研发光学系统、上下基板对位系统,可很好的实现晶粒批量转移,保证加工品质及效率。设备优势: 1.设备配备高精度运动平台及高精密切节平台,上下基板一键调平,保证产品转移精度; 2.设备配备高性能紫外激光器,自主开发高指向性光路系统,光斑大小可调,可应对不同尺寸产品进行转移; 3.设备采用高精度振镜加远心场镜加工系统,加工效率高,可进行选择性转移,灵活度高。



武汉国创光电装备有限公司

2C158

PR200

新型显示喷印RGB功能层装备NEJ-PR200型,是国创科为客户定制开发的装备,已在国家印刷及柔性显示创新中心通过工艺测试及器件制备与点亮验证。技术参数 基板尺寸: 200*200mm 基板厚度: 0.4~1.5mm 运动精度: $\leq \pm 3\mu\text{m}$ 打印精度: $\leq \pm 10\mu\text{m}$ 墨滴体积: 7-12pL(可选配不同型号喷头) 墨滴体积控制: $\pm 5\%$ 缺陷检出率: $\geq 99\%$ 箱内洁净度控制: ISO3 辅助设备: VCD/UV/HPB可选配。



测量仪

内蒙古瀚泰微科技发展有限公司

6E87、6E88

CT300表面形貌测量仪

CT300是一款定制式；多兼容非接触式形貌测量设备，可扫描最大12英寸晶圆和其他大型基板和部件。凭借亚微米的测量精度，能够测量不同的材质，结构，表面参数，几乎涵盖所有类型的表面形貌，是测量平面度，膜厚，关键尺寸等参数的理想设备。设备拥有315×315mm扫描行程，可同时装备多型号白光共焦传感器，具有高达4 kHz的数据采样速率，满足各种高端形貌测量应用。主要用于大尺寸产品表面测量，半导体制造及封装、检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、MEMS器件等超精密加工行业。



半导体设备

深圳市贝思科尔软件技术有限公司

11D021

T3Ster瞬态热阻测试仪

T3Ster是一款先进的半导体器件封装热特性测试仪器。T3Ster用来测量封装半导体器件以及其他电子设备的瞬态热特性，测量的器件包括分离或集成的双极型晶体管、MOS晶体管、常见的三极管、LED封装和半导体闸流管，各种封装类型的IGBT器件及模组模块和大规模集成电路系统（SoC/SiP等）。-半导体器件结温热阻热容测量 -基于结构函数的高精度结构解析 -1us高精度切换和采样率 -支持与热仿真软件进行联合校准 -界面材料热特性测量 -半导体器件老化实验分析和封装缺陷诊断。



广州市科唯仪器有限公司

10A10

高精度全自动影像测量仪

高精度全自动影像测量仪搭载1:13高分辨率自动同轴光学系统，集非接触式影像、激光和接触式探针检测功能于一体，可全面确保精密工件加工工艺的二维尺寸、高度尺寸、空间尺寸准确性。

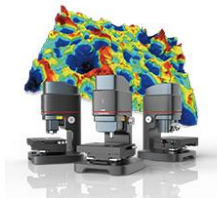


板石智能科技（深圳）有限公司

5D53

AM 7000白光干涉三维形貌测量仪系列

优可测AM系列是一款国产自主品牌的三维形貌测量仪，专注于半导体、光学、PCB、材料、刀具、医疗等行业领域，提供粗糙度、台阶、表面形貌、三维形貌比对、高度、表面轮廓等微观测量，精度达0.002纳米。



抛光机

半导体设备

湖南天创精工科技有限公司

6E81

超精密抛光机床

主要有小磨头抛光机床、磁流变抛光机床、离子束抛光机床和定制化抛光机床。可加工的材料包括但不限于铝、微晶、ULE、熔石英、BK7、K9、蓝宝石、SiC、单晶硅、锗以及其他光学材料。可加工面形有平面、球面、非球面和自由曲面等。小磨头抛光机床面形精度RMS优于 $\lambda/50@ \lambda=632.8\text{nm}$ ；表面粗糙度可达0.5nm。磁流变抛光机床面形精度RMS优于 $\lambda/100@ \lambda=632.8\text{nm}$ ；表面粗糙度优于1.0nm。离子束抛光机床面形精度RMS和表面粗糙度均可达亚纳米精度。



北京特思迪半导体设备有限公司

6C98

CMP抛光机

CMP抛光机是一款针对薄膜（介质层）的抛光设备，操作便捷，兼容性强，通过更换抛光压头实现不同尺寸晶圆的兼容，采用手动装片方式，可配置半自动loading系统，气囊薄膜柔性加压，用于氧化物、金属、STI、SOI、MEMS等产品的平坦化抛光，应用广泛 加压方式：外气囊加压、纳米级去除 驱动形式：抛光压头自转&摆动驱动系统 加工便捷：可配置半自动loading上下片系统 兼容性好：兼容4/6/8inch晶圆 恒温系统：配置红外测温系统，保证抛光盘温度恒定 控制系统：PLC程序。



上海元成光学器材有限公司

3A61

ZEEKO系列光学抛光机

产品特点：可抛光非球面和自由曲面；可抛光如半球，超半球，Wolter掠入射反射镜和许多其他复杂曲面；可抛光如碳化物、晶体材料，低膨胀玻璃、硬质合金、红外材料等许多不同的且难以加工的材料。可执行工序：形状自适应磨削——一种类似于可延展性的研磨形式进行抛光；气囊抛光——经典的Zeeko工艺；射流抛光和超声射流抛光。同时，大型设备可匹配测量塔，如干涉仪等检测仪器。



长沙埃福思科技有限公司

5D52

精密光学离子束抛光机

埃福思科技离子束抛光机采用创新设计的双室结构与卧式加工方案，拥有以下加工特点：高精度、高确定性、非接触式加工、无边缘效应、不产生表面/亚表面损伤；工件立式、装夹操作安全；离子源卧式安装，避免溅射；具备A、B、C等多款机型可选；配套功能强大的工艺计算与控制软件(驻留时间优化、加工预测、加工分析、一键开机、一键停机、定时预约、加工保护、批量加工、自动日志、远程协助等)；配置3坐标测头，具备工件智能定位功能。针对常规光学元件，加工精度RMS优于1nm。



研磨机

苏州博宏源机械制造有限公司

3C21

32BF精密双面平面研磨机/抛光机

主要用于半导体硅片、石英玻璃、蓝宝石、蓝玻璃、陶瓷片、晶体及其他硬脆材料的高精度双面研磨/抛光，尤其对于大尺寸、超薄工件的加工具有明显的优势。采用拉力传感器及电气比例阀，PLC实现压力闭环控制，压力控制精准 下盘采用流体轴承支撑技术，运行平稳，终身免维护，对于大尺寸超薄工件的加工有明显优势 四电机单独拖动，工艺参数（速度、压力、时间等）设置具有配方功能 可配套在线厚度控制装置，有效防止爆盘并可实现在线厚度控制 具有供液系统流量在线监控功能 可选配MES通讯单元，可实现加工工艺数据的抛转及上传下发。



东莞金研精密研磨机械制造有限公司

3D01

双面研磨机KS25D

主要用于光学玻璃、晶体、石英晶片、蓝宝石玻璃、铌酸锂、砷化镓、陶瓷、片状氧化物、硅片、阀板、阀片、摩擦片、刚性密封圈、气缸活塞环、油泵叶片等金属及非金属硬脆材料的双平面研磨及抛光。设备特点：采用日本“SMC”气动元件，分段精密加压控制，适合粗磨、中磨、精磨、抛光等工艺 技术参数：型号：KS25D 磨盘直径（mm）上下磨盘640*235，磨盘转速（r.p.m）3-45 游星轮参数Z=108/M=DP12 游星轮数量5 总功率(KW/380V)8.3 重量（KG）2300。



特鲁利（苏州）材料科技有限公司

2D098、2D099

SemiPOL 高精密度量研磨机

SemiPOL能够对各种材料(光学镜片、半导体晶片、金属非金属晶相)进行精确的研磨抛光，从而进行显微镜(SEM、FIB、TEM等)分析。目标精度微米级。主要作平行研磨抛光，结合更多附件，使复杂异形件及面的研磨抛光更容易。实时监控材料去除量，或量化设定材料磨屑量并实现无人值守操作。双步进电机驱动，分别控制研磨座摆动速度和幅度提高研磨件平面度、光整度及研磨耗材利用率。



沈阳和研科技股份有限公司

10A36

全自动晶圆研磨机-HG5260

HG5260是一款二轴三研磨台盘、晶圆自动传送和上下料的全自动研磨机，装备高刚性气浮主轴，四轴洁净室专用机械手，大量程高分辨率测厚仪等，机台兼容8/12inch两种主流晶圆的背面研磨，实现无需硬件更换的自动尺寸切换功能。



轮廓仪

半导体设备

布鲁克（北京）科技有限公司

5A52

三维光学轮廓仪 ContourX-500

ContourX-500 光学轮廓仪是全球功能最全面的自动化台式系统，可快速完成非接触式三维表面计量。ContourX-500 具有卓越的 Z 轴分辨率和准确度，并具备布鲁克落地式白光干涉（WLI）仪器广受业界认可的所有优势，而占地面积更小。该款轮廓仪可轻松自主配置，适用于从精密加工表面和半导体工艺的质量保证/质量控制（QA/QC）计量到眼科和机电系统（MEMS）器件的研发表征等广泛的复杂应用。

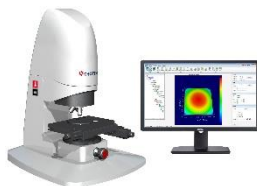


深圳市中图仪器股份有限公司

5B15

光学3D轮廓测量仪

光学3D轮廓仪是利用光学显微技术、白光干涉扫描技术、计算机软件控制技术和PZT垂直扫描技术对工件进行非接触测量，还原出工件3D表面形貌宏观微观信息，并通过软件提供的多种工具对表面形貌进行各种功能参数数据处理，实现对各种工件表面形貌的微纳米测量和分析的光学计量仪器。



上海视珩光学精密仪器有限公司

5C25

S neox 3D光学轮廓仪

S neox 是高性能非接触式 3D 光学轮廓显微镜系统，专为亚纳米、纳米和微尺度级测量而设计，具有先进的检查和分析功能，在设计、功能、效率和性能方面均优于现有的光学 3D 轮廓分析显微镜。除此之外，它最令人印象深刻的特点是它无与伦比的速度。借助新的智能独特算法，一切都变得更快。数据采集速度为 180 fps。S neox 将标准测量的采集速度较之前提高 5 倍，这使其成为市面上最快的区域测量系统。



优尼康科技有限公司

5D61

P-7 探针式表面轮廓仪/台阶仪

P-7支持从几纳米到一毫米的台阶高度测量，适用于生产和研发环境。该系统可以对台阶高度、粗糙度、翘曲度和应力进行2D和3D测量，其扫描可达150mm而无需图像拼接。



真空镀膜设备

广东汇成真空科技股份有限公司

1B29

柔性电子卷绕真空镀膜设备

该系列设备采用直流磁控溅射、射频/中频反应磁控溅射等技术灵活组合，模块化概念和独特技术确保高质量生产。在PET、PI、PC、COP等柔性聚合物、金属带等带状卷材表面进行连续镀膜，镀铝、钛、铬、铜、镍铬、镍、银等金属材料，TiO₂、Nb₂O₅、SiO₂、ITO、SiAlO_x、MoO_x等氧化物。



半导体设备

成都国泰真空设备有限公司

1C55

光学真空镀膜机

GT1150光学镀膜机优选节能环保无油的分子泵配置，抽速快且稳定性好，配置自主专利RF射频离子源，性能超越同类进口组件，使产品膜层致密度、温漂问题得到本质上的改善；集成透射/反射式直控光控，可支持宽范围波长(400~2400nm)，具有高精度（监控波长精度<1nm,重复性<0.25nm），强力支持生产高品质的IR-CUT和带通滤光片等产品；集成自主研发ACS镀膜系统，实现熔料、镀膜等全流程自动化和可视化，完善的工艺EXCEL文件管理和过程数据和报警等日志自动保存，方便产品质量管控和问题追溯。



杰莱特（苏州）精密仪器有限公司

1D32

离子束溅射镀膜机

离子溅射镀膜机应用于光通讯滤光片（Lan-WDM、MWDM、DWDM100G）、生物医疗荧光滤光片、半导体芯片、紫外膜、高损伤阈值激光膜等的批量生产。

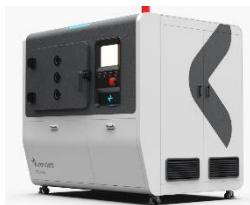


深圳奥兰科技有限责任公司

2D108

奥兰Dolphin真空镀膜机

奥兰自主开发、设计和建造了的Dolphin系列镀膜机，为客户提供NFO解决方案，通过等离子引发聚合反应在产品表面形成疏水疏油纳米薄膜。奥兰Dolphin系列镀膜机支持模块化可定制，电极布置更均匀，能量密度更高，沉积速率快约50%，处于国际领先地位。奥兰拥有完全自主知识产权，国产化率超过90%，打破了国外的技术垄断，可以完全替代国外同类产品。



探针台

三河建华高科有限责任公司

4B105

探针测试设备

探针测试设备处于国内领先技术水平，用于各种半导体器件芯片的电参数测试。



半导体设备

深圳市易捷测试技术有限公司

6E85、6E86

硅光探针台TS-3000SiPH

大多硅光半导体商家通常在切割前对PIC芯片进行晶圆级测试，以尽早发现缺陷，避免封装有缺陷的芯片。GBITEST+MPI+PI硅光子晶圆测试系统通过特别设计的光纤硬件和软件，以及高精度的定位软件，对进出每个芯片的光进行耦合。还可以使用光纤阵列同时耦合多个器件。快速的精密耦合可在瞬间内完成对光的耦合优化。



中科睿华科技（北京）有限公司

6C88

探针台

TS2000 SE 是MPI推出的旗舰级8寸半自动探针台，在多个方面提供了标杆式创新。1、建模：IV/CV/PIV。2、RF 测试：26GHz-110GHz。3、mmW测试：丰富的选项可以无缝支持主流扩频品牌的拓展。4、失效分析。5、探卡测试。6、提供室温~300°C&-60°C~300°C（SE系列）长时间测试环境。7、1/f 噪声测试的最佳选择。在多个方面实现了业内首创：两种Wafer；loading方式：常规前端和业内首创的侧面单片自动loading；Vertical Control。



上海菲莱测试技术有限公司

10D69

VCSEL晶圆探针台

支持以CW或QCW输出的LIV+光谱测试，FF、NF测试（含M2和发散角测试）模块化设计，可自由搭配不同测试模块，方便集成和维护 全自动开发的测试软件，计算参数可根据客户需求定制 支持断电续测，坏点重测，连续同一失效模式报警 支持测试时间，数量，时间，移动率，探针使用次数等信息统计 支持mapping选择缩圈、抽测、制定区域测试等功能 使用水冷+TEC技术进行温度控制，温度可控范围大，且有极高的稳定性和准确性 支持客户MES系统的对接，保证数据的安全性和可追溯性 优异的ESD和EOS防范措施。



清洗机

东莞市熙科机电设备有限公司

4D120、4D121

晶圆清洗机

本产品是本公司自行研制的全自动清洗机，兼容性强，适合 12“、8”、以及 8”以下晶圆切割后清洗使用。特点：1.外表美观、坚固可靠、性能优越；2.操作面板采用人机界面，使用户操作更直观；3.出现故障在屏幕中显示详细故障原因，可直接进行故障修复，大大缩短了维修时间，从而提高了工作效率；4.工作压力可调，清洗时间、转速可根据需要更改，并设有密码保护，从而满足了更多用户的需求。



半导体设备

中科光智（重庆）科技有限公司

10E91

真空微波等离子清洗机

我们的设备产品主要用于半导体或光电芯片的封装工艺以及其他先进工业制造，包括微波等离子清洗机、真空回流焊炉和惰性气体手套箱。其中等离子清洗机用于材料微观表面净化、活化、改性等处理，真空回流焊炉用于高功率芯片与电路板之间的无空洞回流焊，惰性气体手套箱用于军用级电子元器件封装的环境气氛控制（配套气密性封焊设备使用）。



上海央米智能科技有限公司

1C70

槽式兆声清洗机

兆声清洗机，清洗均匀、细微的损伤基本没有、最适用于半导体晶片和HDD部品等的超精密清洗。利用加速度和化学的作用除去微米以下的颗粒。可设定对应不同的清洗物以及装置的各种形状的振板。接液部的材质对应于清洗液和洁净度，使用不锈钢-铝-石英等材料来制作。



烟台金鹰科技有限公司

1D21A

等离子清洗机

GDR系列低压等离子清洗系统由真空腔体及高频等离子电源、抽真空系统、充气系统、自动控制系统等部分组成。



固化设备

半导体设备

广州市邦沃电子科技有限公司

7A78

全自动无极灯UV固化设备

邦沃科技研制的全自动无极灯UV固化设备，在线式工作模式，采用全波段无极灯光源，可固化各类UV材料，兼容种类繁多的产品紫外光固化。广泛应用于3C行业，新能源电池生产，PCB三防胶固化，电子半导体，光通信行业，医疗及生物领域，印刷涂敷等各种行业领域。



深圳市海特奈德光电科技有限公司

7D02

自动化UVLED固化设备（显示屏）

自动扫码上传MES系统+UVLED固化+自动检测UV能量+自动上下料+治具回流全自动化，工业4.0对接 防产品漏UV固化 电流检测，能量检测。



深圳市永成光电子股份有限公司

7B23

UVLED固化箱

采用模块式排列方式，主要运用于手机组件、塑胶组件等行业粘合；电子元器件、液晶片、电子胶封胶水固化；光源通常选用365NM，385NM，395NM，405NM等。可进行自由组合各个波长，出光角度、出光距离、出光范围都可以根据客户本身量身定制。UVLED固化系统操作简单即开即亮，省掉待机电量消耗，提高生产效率。光输出稳定均匀，照射均匀效果好。



武汉优炜芯科技有限公司

10B73

电子胶粘剂固化设备

电子胶粘剂固化设备，性能可靠，光功率高，光照均匀度大于90%，功耗低。应用于摄像头模组组装、光通讯无源器件组装、激光器泵浦源组装、医疗器械UV粘结、手机组装、硬盘组装、PCB线路板制图、PCB阻焊曝光、高精密线路曝光等领域。

产品英文简介:



划片机

河北圣昊光电科技有限公司

10D51

LD/PD芯片划片机

LD/PD芯片划片机是主要用于化合物半导体材料（砷化镓、磷化铟等）芯片在常温条件下的对位、相机定位，同时完成砷化镓芯片的划切功能。划刀荷重分段测量，更稳定，更精确的表示当前荷重，自动模式和手动模式相机辅助效果良好。



郑州琦升精密制造有限公司

4A050

划片机

主要同于半导体封装行业的专用切割设备，针对QFN、BGA、PCB板等设计的具备大行程，自动识别的专用设备，配备大功率直流主轴，可切割难加工产品。



深圳市纬迪科技有限公司

10E81

WAD3900双轴精密划片机

1.双轴切割模式，效率比单轴切割产能提高80%以上； 2.主轴对装龙门结构，双刀间距最小24mm,双轴切割工艺适应范围更广； 3.可以满足最大310mmx310mm材料的高精密切割加工； 4.重复定位精度0.001mm； 5.可选倍率双显微镜视觉系统，工艺适应范围广； 6.触控教学式GUI，多片预切割模式，程序编辑简单便捷； 7.自动对准、自动切割、自动刀痕检测功能，减少工作人员工作量，有效提高生产效率； 8.选配功能：BBD刀片破损检测、NCS非接触测高。



无锡立朵科技有限公司

1A15

8寸单轴半自动划片机

LAD5100 — 8寸单轴半自动划片机 专注于研发和生产6寸、8寸、12寸系列精密划片机，为客户提供优质的划切设备与完整的划切工艺解决方案。公司设备主要应用于半导体、功率器件、化合物芯片、LED、陶瓷、玻璃、QFN、DFN、BGA等产品的切割和封装。



检测设备

半导体设备

深圳市汉诺精密科技有限公司

4C040

EFEM晶圆检测平台

EFEM晶圆检测平台 天然花岗岩直线电机平台，优秀的速度波动，静音运行 亚微米级定位精度、重复定位精度 条码、标签及字元辨识，完整追踪生产历程。提供即时影像监控。高效净化及静电消除等微环境控制，确保传送过程中不受污染。自动压力控制系统可以通过环境压力变化，调节风扇转速以保持设定值。提供客制化晶圆或其它基板搬运需求。产品应用 半导体产业：晶圆传送、晶圆翻转传送、铁框（Frame）传送 LED产业：蓝宝石基板传送、胶环（Grip ring）传送、面板传送。



恩纳基智能科技有限公司无锡有限公司

10D31

AOI智能外观检测设备

应用领域：适用于模块、科研院所、各类压力、温湿度、霍尔等各类IC、光模块VCSEL、TIA、PD、MPD等芯片类的外观检。硬件配置：1、最高检测精度0.25 μm，可同步处理50片晶圆检测；2、搭配高分辨率彩色工业相机，可适应不同材质、颜色芯片；3、支持多面检测方式；4、备有多款配置，适应检测晶圆片、焊线后芯片和切割后成品芯片为主，搭载自动上下料模组，检测精度高，速度快，检测能力稳定。

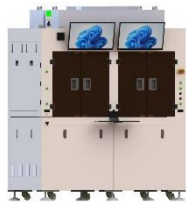


深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2B036

全自动芯片四面外观检测设备

全自动芯片四面外观检测设备主要应用于：光通讯、高功率激光芯片等单芯片外观检测。设备尺寸：L1800*W1250*H1900mm。使用环境：建议100-1000级无尘车间；FFU*2，温度22-26℃，相对湿度50%-60%。检测芯片尺寸：长*宽*厚=（150-5500）*（250-600）*（90-500）μm。



广东西尼科技有限公司

2C030、2C031

SN-VR-C12标准六面视觉检测设备

主要应用于电感、晶片、晶振、芯片、半导体、滤波器、锂电磁、LED封装等产品。主要检测暗裂、崩缺、脏污、缺角、水印、变形、外形（长宽高）、刮伤等缺陷。功能：检测外观缺陷、尺寸、计数分装 效率：600-6000pcs/min。



光谱仪

上海如海光电科技有限公司

4C190

Spider2000便携式二维
拉曼成像光谱仪

该产品采用如海光电自主研发的科研级微型共焦拉曼光谱仪RMS2000作为拉曼内芯，从而使得它拥有高灵敏度、高分辨率、强穿透能力以及较好的抑制荧光干扰能力。优化的光路设计可使得拉曼激光光束在通过长焦显微物镜后最小光斑可达到微米级别，可精确采集微米级样品的拉曼光谱。采用了高精度二维自动化移动平台，可实现自动扫描mapping成像功能；配备了专门为拉曼系统设计的物镜，使得激光光斑接近衍射极限，克服了普通拉曼系统中收集拉曼信号的焦面稍高于或稍低于实际最佳焦面的问题。



半
导
体
设
备

河南雷神光电技术有限公司

4C182、4C185

便携式傅里叶红外光谱仪

LSPEC 5010 便携式傅里叶红外光谱仪是一款具有较强的适应性，可以适应当前绝大多数应用的使用环境。仪器采用双角镜扭摆式干涉仪结构，具有测量精度高、稳定性好、使用寿命长等特点。仪器具有完全一体化且可靠的通用采样功能，轻松进行测量并提供各种便携配件，是实验室和现场测试环境的理想选择。



北京爱万提斯科技有限公司

4D049、4D050

近红外光谱仪

Avantes公司有很多型号的近红外光谱仪，2.x系列扩展型InGaAs光谱仪采用256或512像元探测器，测量光谱范围可到2500nm。HSC是AvaSpec-NIR2.5TEC光谱仪的改进版，具有更高的灵敏度、更轻的重量和更小的体积。它基于100mm焦距和0.13数值孔径的光学平台，在分辨率和灵敏度之间取得了平衡。



岛津企业管理（中国）有限公司

5D26

岛津傅立叶红外光谱仪IRTracer-100

适用于红外波段光学元件的透射率，反射率、半导体元件镀膜分析。



蚀刻机 / 等离子去胶机

SENTECH仪器开发

10C56

SI 500 C with Casette loading

SI 500 C能够应用广泛的等离子体蚀刻工艺，从普通的RIE到高密度的工艺。RIE到高密度工艺，特别是在低至-150°C的极低温度下。



scia Systems GmbH

5C32

离子束刻蚀系统 (IBE)

scia Mill 150适用于在多种材料复杂多层膜上的微结构刻蚀。该系统兼容活性气体，能够进行反应蚀刻工艺以提高选择性和刻蚀速率。由于其节省空间的设计，scia Mill 150是小规模生产和研发应用的理想选择。



无锡邑文微电子科技股份有限公司

5A38

Strip去胶系列设备

单腔单片或两腔Twin wafer去胶设备，配置高精度传送手臂，电感耦合等离子体源，高精度控温热板模块等。具有操作简单、占用空间小，产能效率高，耗材成本及运营成本低等优点。广泛应用于4英寸~8英寸硅基/碳化硅/氮化镓/砷化镓等产线的去胶。



北京哲勤科技有限公司

5A82

IoN Wave 10 微波
等离子体去胶机

IoN Wave 10是PVA TePla在微波等离子体处理工艺中的最新产品。该设备尺寸适中、性能先进。IoN Wave 10配置最新的性能出色的组件和软件，对工艺参数进行精确控制。实现最严格的质量控制。IoN Wave 10安装和维护简单。微波等离子技术，提供了极高的光刻胶灰化速度，降低了在静电放电中的风险。应用：光刻胶灰化 去除牺牲层 (PI等) 去除底膜 晶圆和衬底的清洁 刻蚀钝化层 (氮化硅等) SU-8灰化 去除聚合物 边缘刻蚀 (去除PSG层) 失效分析中的器件/PCB开封。



焊接设备

深圳市锐博自动化设备有限公司

10C71

超声波金属焊机 UT-400

UT-400是IGBT端子焊接制程中，加压于金属端子并通过超声波高频振动使端子与底板键合的生产设备。设备采用200*300mm载盘，通过更改载盘和少部分零件即可切换生产产品。

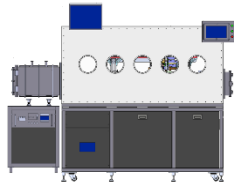


北京科信机电技术研究所有限公司

10C28-1

PXH-1 自动平行缝焊机

适用于2~150mm 尺寸的晶体和声表面波器件、光学器件、功率器件、传感器和MEMS器件的封装。焊接速率：0.1-20mm/s；焊接压力：0.5-2Kg；焊接功率：2kW；焊接盖板厚度：0.08-0.2mm；视觉定位分辨率：4.4μm；视觉对位精度：±0.035mm（25×25mm产品尺寸）；工作室露点：≤ -40℃ 漏率：符合国军标规定（GJB548B-2005）；焊接电源：逆变式脉冲焊接电源；供电电源：单相 220V、2kVA（含烘烤箱）。



宏盛迅达科技（深圳）有限公司

10E92

激光耦合焊机EL-2000

应用于光器件100G，400G，800G的TOSA,ROSA等产品的自动耦合焊接，配置多种进口仪表，米亚基激光器，专业透镜夹具，24维多自由度滑台组合，XYZ轴滑台行程20-70mm，滑台精度0.1μ，旋转度720°，角度精度0.0005°，3光束激光焊枪120°均匀分布，能量差异<3%，各类产品生产合格率达98%，生产效率高，稳定性强，操作简捷，可根据客户需求定制各种专业夹具控制软件。



北京日月威科技有限公司

4T006

MPH-660D激光植球焊接设备

MPH-660D高精密微焊接设备实现非接触式精密微焊接以及各类芯片及晶圆上植球，应用于手机摄像头模组、汽车电子产品、军工产品、软硬结合板、TWS耳机、半导体电子、SMT/DIP等领域，3C行业等。焊接优点：焊点透析好、焊点牢固，焊接速度快、无接触对产品无损伤、无需助焊剂，无空焊、虚焊、冷焊等不良出现，可以直接定点隔空焊接工艺难点，操作简单，占地面积少。也是国内唯一可以支持100μm球径以下焊接的激光设备供应商（球径范围：40~1500μm）。



打标设备

半导体设备

海目星激光科技集团股份有限公司

4B085

全自动PCB激光打标机

全自动双头PCB激光打标机是用激光器在PCB表面雕刻一维码、二维码、文字、符号或图形的专业激光加工设备。适用于SMT生产中的PCB，半导体LCD，半导体芯片等物体表面上标记内容，可用于PCB打二维码标签，用于上线扫描，追溯贴片物料，ICT、FCT、智能测试系统进行联网追溯。特点：（1）可配置高性能光纤、绿光、紫外激光，功率可调；（2）真同轴上下双头打标系统，高效双面雕刻；（3）高精度视觉定位保证打标位置精度，并在打标后确认打印内容和质量。



湖南健坤精密科技有限公司

4D126

3D激光打标机

光纤/绿光/紫外/CO2动态聚焦扫描系统打标机适合于大范围激光标刻、切割、钻孔、激光微细加工、三维应用、激光快速成型等，根据选型可对不同材料进行加工。



北京法普瑞智能科技有限公司

2C026

V2000bw 系列UV激光打标机

1. 外腔防护等级IP65，内外腔双层密封，且均有惰性气体保护。2. LBO晶体电动移点技术，光源使用寿命提升5-8倍。3. 采用最新第三代空气过滤单元，湿度控制<0.2%。4. 机身颜色采用超音速火焰喷射技术，将颜料镀层瞬间液化，实现离子等级均匀分布。5. 采用法普瑞智能的顶级产品专用的紫红色，视觉效果，应运而生。6. 全新设计结构，激光头重量减少50%，体积减少40%。7. 顶级的光束质量，满足高级别、特殊级别的加工要求。



深圳互喜智联科技有限公司

10D65

晶圆激光打标设备

Laser Marker可提供Laser and OCR/Only Laser两种模式选择。一款设备可实现Laser Marker和Sorter两者功能。



切割设备

先进微电子装备（郑州）有限公司

10C35

8230 全自动双轴12吋切割机

ADT 8230是一款高效率、高性能、低成本的双轴（对向）全自动晶圆切割机。最大切割工件尺寸可达12英寸。支持最大3英寸刀片，可选择1.8KW或2.2KW大功率主轴。使用17英寸触摸显示屏，操作界面直观。最新开发的图形用户界面集成了面向客户使用的快捷操作功能。设备搭载快速自动对齐、切割定位等功能，具备高精度自动刀痕检测和切割质量分析能力。广泛应用于晶圆、各类封装、分立器件以及MEMS等半导体产品的精密切割。



半
导
体
设
备

深圳市韵腾激光科技有限公司

4A060

全自动SD卡激光切割设备

机台特点：1、精密型设备，占用空间小，性能稳定。2、双光路系统同步作业，加工精度更精准。3、独创的光学系统，光束质量好，切割效率高。4、可实现产品自动上料，检测，切割，下料等功能。



唐山晶玉科技股份有限公司

3B85

多线切割机YBDX5056-III

YBDX5056-III多线切割机主要用于金刚石线切割单晶硅、陶瓷、玻璃、贵金属等硬脆材料的切片加工。该设备具有精密温度控制系统，切片精度高，翘曲度小，切片质量稳定，切割成本低。



沈阳科晶自动化设备有限公司

1C27

STX-202A小型金刚石线切割机

STX-202A小型金刚石线切割机是专为材料研究人员而设计，用于脆性材料样品的精密切割，可以对材料进行切片、切断、开方等，旋转转台也可以对试样切割一定角度。可切割的材料包含陶瓷、晶体、玻璃、金属、岩石、热电材料、红外光学材料、复合材料以及生物医学材料等。切割后的样品尺寸精度高，在 $\pm 10\mu\text{m}$ 的范围内。切割线采用单根线循环往复的运动模式，可使用的线的长度长，一次上线的使用寿命长，提高了切割效率。用其进行超薄精密切割时，切得的薄片（约1英寸范围内）厚度可以达到0.08mm。



钻孔设备

深圳市韵腾激光科技有限公司

4A060

FPC激光钻孔设备

机台特点：1、可实现卷对卷、片对片的加工方式。2、采用超快激光钻孔，可加工通孔、盲孔，精准而高效。3、可选上下料方式，自动放板或人工放板4、四轴联动，可实现任意尺寸的无缝衔接切割。



半
导
体
设
备

江苏鸿鹄激光科技有限公司

4D122、4D125

玻璃激光钻孔机

公司自主研发的激光一体化自动玻璃切割/钻孔机，加工速度快、精度高，深受广大触控屏生产厂商的赞誉。公司的激光器产品广泛应用于车载玻璃和车载显示、3C 消费电子、显示屏行业、半导体行业、光伏玻璃打孔等领域的精细加工。



锐莱特精密光电技术无锡有限公司

4A172

玻璃激光钻孔机

RayGlass C0906系列玻璃激光打孔机具有如下特点：1、打孔速度快，精度高，稳定性好，品质高，成品率高；2、可直接加工圆孔、方孔、阶梯孔、异型孔、任意曲线图形等，图形完全由电脑程式化设定；3、玻璃最大尺寸可达900*600mm；4、操作简单、效率高、玻璃无需用水冷却；5、可直接加工多种玻璃、石英等透明脆性材料。



普爱纳米位移技术（上海）有限公司

7A52

高密度微孔的激光钻孔

应用于高密度微孔的激光钻孔，可以应对高度受控的孔锥度。该运动解决方案的主要特点：1. 高精度特征形状 增高的孔密度 2.精密的锥度控制 3.一致、清洁且快速的钻孔过程 4.高处理能力 5.易于激光集成。





重点展示半导体材料

展示范围：晶圆、陶瓷、靶材、UV减粘膜、抛光液、砂轮、研磨材料、基板、光刻胶、模具材料、焊料

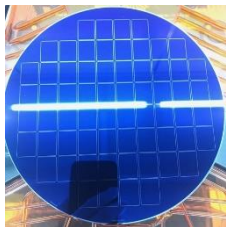
晶圆

长春长光圆辰微电子有限公司

6B96

8寸背照式混合键合晶圆

利用键合设备，搭配对准系统，晶圆对准精度小于500nm。通过检测设备，晶圆键合率大于99.98%。键合力大于1.9J/m²。混合键合（Hybrid Bonding）CIS wafer + ROIC wafer hybrid bonding。



广州绿晶玻璃有限公司

3B89

玻璃晶圆

我司可提供各尺寸厚度及多种材质的光学玻璃晶圆，具有出色的耐热透光性能、良好的化学稳定性、较高的面型精度及外观质量，符合常规的加工要求和工业标准（SEMI等），主要应用于微光学、MEMS、晶圆级封装、生物工程以及各种指定应用。



深圳市唯锐科技有限公司

8E64、8E65

VIGO公司III-V族
/VCSEL/InGaAs外延晶圆

波兰VIGO公司成立于1993年，拥有一支超过30年红外探测器研究经验的资深专家队伍，是MCT/InAs/InAsSb探测器的领先设计者和制造商，提供低温制冷的红外探测器、III-V族外延片，覆盖1-16μm光谱范围，同时提供探测器模块、前置放大器、TEC温控等组件和解决方案。提供VCSEL晶圆和InGaAs晶圆。

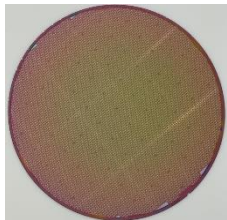


上海微技术工业研究院

6A130

红外温度传感器晶圆

上海工研院自主研发的红外温度传感器芯片，性能指标超越国际主流产品，良率>99%，广泛应用于额温枪、耳温枪和工业温枪，是国内最好的进口替代产品。新冠期间，依托上海工研院8英寸研发中试线，迅速整合完善国内产业链资源，生产了4000多万只测温枪所需传感器芯片，2020年上半年市场占有率全球最高（超50%），极大缓解了防控物资紧缺的压力，得到“国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制”（医疗物资保障组）的嘉奖。



陶瓷

六安鸿安信电子科技有限公司

11E615

CSOP陶瓷封装管壳

CSOP(Ceramic small outline package)陶瓷小外形封装是一种小型化的贴装外壳,其翼型引线更有利于吸收外壳与PCB之间的应力,提高可靠性。广泛应用于放大器、驱动器、存储器、比较器等。

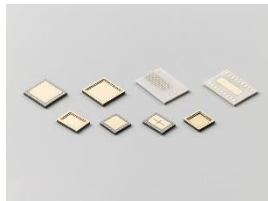


株洲艾森达新材料科技有限公司

11C29-2

HTCC

高温共烧陶瓷即为HTCC(High-temperature co-fired ceramics),主要以氧化铝或化铝生瓷带和、组、等高点金属浆料为主要原料,通过丝网印刷的方式将浆料印周在生瓷带上构成金属电路,并采用通孔填孔的方式使上下层导通,再进行多层叠合和高温烧结(其中氧化铝HTCC烧结温度在1500以上,氮化铝HTCC烧结温度在1800以上),最后经过电镀、烧焊等工艺,形成一个三维布线系统的单片结构,具有耐腐蚀、耐高温、寿命长、高效节能、温度均匀、导热性能良好、热补偿速度快等优点。



厦门新瓷材料科技有限公司

5A92

激光陶瓷反射体/漫反射体

陶瓷反射体广泛应用于激光泵浦腔中,与镀金反射体比较最大优势在于其使用寿命极长。我们提供各种型号的灯泵浦固体激光器用陶瓷体、半导体泵浦模块专用陶瓷体和美容和光子嫩肤用陶瓷体等。高反射率陶瓷材料在可见光区(380nm—780nm)光谱平均反射率高达97%以上。

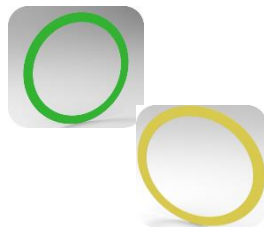


扬州瓷光光电有限公司

4D177、4D178

荧光陶瓷、透明陶瓷

荧光陶瓷是一种基于先进透明陶瓷的新型荧光转换材料。通过陶瓷材料配方和晶体结构设计,使其具备色温可调、抗热冲击、发光稳定、发光效率高及寿命长等优势。本公司也可针对具体照明应用进行产品设计。



靶材 / UV减粘膜

福建阿石创新材料股份有限公司

1B43

溅射靶材

阿石创提供各类金属、非金属、合金及化合物材质的溅射靶材，包括平面溅射靶材及旋转溅射靶材两大类，应用领域包括平板显示、TP、精密光学、太阳能、装饰镀膜、光磁存储等。

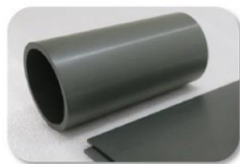


广州新视界光电科技有限公司

2A100

金属氧化物半导体靶材

新视界可提供用于制作TFT有源层的溅射靶材（多种尺寸平面靶和旋转靶）。材料迁移率最高可达 $50\text{cm}^2/\text{Vs}$ ，具备极佳的光热稳定性。靶材密度可达 6.54 g/cm^3 ，目前已在4.5代线上完成验证。此外，新视界还可以提供多种靶材（3~6英寸）验证。



郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

3C23

UV减粘膜

UV减粘膜是一种特种胶带，其常态下具有很强的粘性，经UV光照射后粘性急剧降低，通常用于工件研磨、切割等制程的支撑及保护。

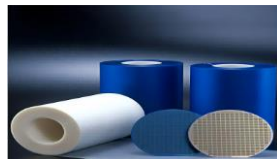


广东序轮科技有限公司

11D052

UV减粘膜

UV膜是在各种硅片、封装基板、陶瓷、玻璃、水晶等多种工件的切割工程中使用的胶带，以具有优异拉伸特性的PO、PVC膜为底材，切割产品时可以坚固地固定产品，UV照射后，胶带的粘性减弱，切割后产品容易剥离。序轮公司生产的UV膜品种齐全，胶层有多种厚度（5-25um），具备防静电型，实现Easy Pick-up(容易剥离)，对EMC(Epoxy Molding Compound 半导体环氧合成高分子封装材料)等较难接着的工件，也具有优质的贴附性。



抛光液

湖南皓志科技股份有限公司

3C11

SIC抛光液

应用于第三代半导体材料碳化硅晶片的抛光工序，碳化硅材料具备超硬特性，常规氧化硅抛光液存在抛光效率慢的问题，本产品在Si面碳化硅抛光上具有很好的表现，它有高效的去除速率，抛光后的碳化硅表面缺陷较少，同时在抛C面碳化硅时亦可以获得良好的表面质量，从而确保被抛工件有较高的抛光效率及良品率，提高客户产品竞争力。



无锡吉致电子科技有限公司

8D13

抛光液

抛光液、研磨液、slurry、氧化硅抛光液、氧化铝抛光液、金刚石抛光液、氧化铈抛光液。



半
导
体
材
料

圣戈班西普磨介（邯郸）有限公司

5A95

氧化铝碳化硅抛光液

圣戈班精密抛磨提供碳化硅加工-切磨抛洗全流程解决方案，提高抛光效率，减少表面质量缺陷，同时兼具性价比。此外，研发了适用于氮化镓、蓝宝石等的高功能纳米磨料抛光液。



东莞市粤成新材料有限公司

1B76

二氧化硅抛光液

采用高纯硅溶胶为原料，经特殊工艺和配方制成，可根据不同的产品和抛光要求配制。主要用于：光学玻璃、蓝宝石、陶瓷、硬盘、半导体、金属等材质抛光。



砂轮

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

3C23

光学器件封装切割用超硬材料砂轮

高精度超薄超硬材料切割砂轮主要用于光学玻璃、滤光片等光电行业器件的切断与开槽。具有精度高、切缝小、加工表面质量好等一些列优点。



郑州琦升精密制造有限公司

4A050

减薄砂轮

主要用于LED行业蓝宝石外延片背减薄加工，可加工2寸、4寸、6寸外延片。



深圳市胜航钻石工具有限公司

3D74

金刚石陶瓷砂轮、树脂砂轮

我公司主要生产金刚石陶瓷砂轮、树脂砂轮、金刚石磨盘、金刚石钻头等产品。



郑州德卡特超硬工具有限公司

11E632

陶瓷金刚石砂轮

陶瓷金刚石砂轮主要用于磨：晶圆半导体硅片、太阳能硅片、PCD金刚石刀具，PCBN立方氮化硼刀具，聚晶金刚石复合片，蓝/宝石刀具，钻石刀具，钨钢硬质合金刀具，陶瓷，玻璃，水晶，蓝宝石和微晶，稀土材料磁性材料等高硬脆材料的机械加工中，并取得了良好的经济效益。可选形状：平行、杯型、碗型、碟型。



研磨材料

深圳中机新材料有限公司

5A81

团聚金刚石研磨液

在团聚钻石粉的基础上增加了组合刃角的数量，并增加了聚合强度，使其保留多刃角的特性，更适用于对表面要求质量高，且对去除速率要求较高的应用场景，并可以加工成各种结合剂的磨削工具，应用于各种硬质金属及非金属材料的高速研磨。主要特征：1.原料自主研发,选择优质金刚石原材料合成多晶结构金刚石,用于金刚石液。2.特殊配方、分散性好、粒度均匀、去除率高、低损伤层。3.产品研磨速率稳定、使用率高、切削速率快、加工表面一致性好。4.具有多棱外形特征，微观呈现多刃结构，略呈天然矿物光泽。5.较高的切削能力。

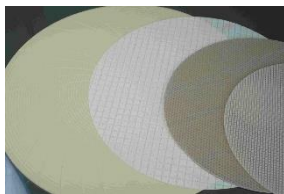


河南联合精密材料股份有限公司

2D120

研磨垫

提供多种金刚石研磨(抛光)产品，包括油基、水基、醇基等不同的载体类型，多晶金刚石、单晶金刚石、纳米金刚石等多种磨料种类，为不同材料、不同要求的精密研磨抛。



半
导
体
材
料

深圳市新誉通光电有限公司

9D93

光纤研磨片

公司生产的研磨纸及研磨液系列产品能够满足各类光纤连接器，跳线，陶瓷插芯，光有源器件，光无源器件，MTR-MPO器件的研磨需求。



北京国瑞升科技股份有限公司

9D72

半导体行业研磨抛光解决方案

国瑞升半导体精密抛光配套产品、抛光工艺及整体解决方案，得到业内标杆客户认可，形成批量采购订单，完美替代国外竞品：1、磷化铟/砷化镓第二代化合物半导体材料 选择特定形貌和一定晶型的磨料，与匹配的抛光助剂，通过成熟的配制工艺可提升20%的抛光速率。2、碳化硅/氮化镓第三代化合物半导体材料 形成一整套的解决方案，并开发出一种粗抛液，大大提升硬质材料的去除速率，降低精抛工序压力，减少工序流程和加工时间。



基板

长春长光精瓷复合材料有限公司

6B96

碳化硅散热基板

碳化硅散热基板，具有导热率高、热稳定性好、尺寸稳定性高等特点，与硅半导体材料性能匹配，可用于CMOS等大规模集成电路器件、大功率模块等散热安装基板。



福建华清电子材料科技有限公司

6C147

氧化铝陶瓷基板

良好的导热性，优良的机械强度，物理和化学特性稳定，耐腐蚀，良好的绝缘性能。



金川岛新材料科技（深圳）有限公司

4E001

厚膜印刷陶瓷基板

运用丝网印刷技术，采用多层印刷方式将银浆、玻璃釉印刷在陶瓷基板上，经高温烧结形成陶瓷金属化。



佛山华智新材料有限公司

4B005、4B006

氮化硅陶瓷基板

热导率高，抗弯强度高，热膨胀系数可匹配Si/SiC芯片。



光刻胶

苏州研材微纳科技有限公司

6B87、6B88

光刻胶

光刻胶又称光致抗蚀剂，是一种对光敏感的有机化合物溶液。其组成部分包括：光引发剂（包括光增感剂、光致酸剂）、光刻胶树脂、单体、溶剂和其他助剂。光刻胶在受紫外曝光后，在显影溶液中的溶解度会发生变化。晶片制造中所用的光刻胶通常以液态临时涂覆在表面，而后被干燥成胶膜。通过曝光来传递设计图案。研材提供紫外光刻胶，电子束光刻胶，微流控应用光刻胶，LIFT-OFF应用光刻胶，临时/永久键合胶，封装用PI等光刻胶。

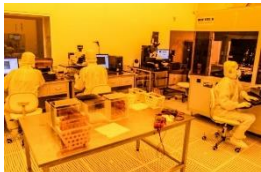


广州新视界光电科技有限公司

2A100

光刻胶验证

可为客户验证多样的光刻胶材料，包括验证涂布，烘烤，曝光，显影工艺，以及评价其图形化质量。此外，新视界还可以验证多样的显影、刻蚀、脱膜药液。



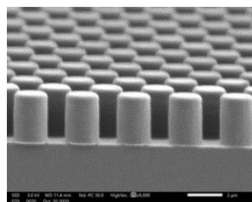
半导体材料

潍坊星泰克微电子材料有限公司

2D006

SUN-1601N热辅助紫外压印光刻胶

SUN-1601N热辅助紫外压印光刻胶采用安全溶剂，具有良好的流动性、高感光性、高对比度、高产率，及耐抗刻蚀性等诸多优点。配方专为i-线和g-线光刻优化，可广泛应用于图形化蓝宝石衬底及压印相关半导体的制造领域。



璞璘科技（杭州）有限公司

5A09

全系列纳米压印材料

热固化纳米压印光刻胶、普通紫外光固化纳米压印光刻胶、紫外光固化纳米压印和光刻两用胶、抗氧紫外光固化纳米压印材料、抗刻蚀紫外光固化纳米压印材料、高折射紫外光固化纳米压印光刻胶、喷涂式紫外光纳米压印光刻胶材料、快速模板胶材料、表面处理材料：防粘剂、增粘剂等。为客户量身打造专业用途的纳米压印胶材料。



模具材料 / 焊料

深圳市博金硬质工具有限公司

1D09

0201编带冲孔模具

微型元件载体方孔冲模，替代日本进口；最低寿命达一亿次，还适应不同的纸带材质，很受客户欢迎。



杭州欧光芯科技有限公司

5A15

模具

纳米压印模具，提供纳米压印所需的原始模具，子模具及工作模具加工服务。根据客户要求，使用电子束直写，光刻，刻蚀等多种加工工艺，为客户定制模具。



成都佩克斯新材料有限公司

12E637

预成型合金焊片
Solder Performs

佩克斯新材料预成型焊片是一种表面平整的焊料薄片，常用于陶瓷、可伐合金、芯片、IC封装、金属管壳等之间的焊接。我们可以根据客户的需求，定制成各种形状的预成型焊片，包括长条箔带、长方形、正方形、方形框、圆形、圆环形、椭圆形及非标准形状等等。



广州先艺电子科技有限公司

12B908

金锡焊膏

金锡焊膏作为一种高可靠性高温焊膏，服役温度范围较高的场合，具有热疲劳性能好、在高温下强度高、抗腐蚀与抗氧化性能优异的特点。相较于金锡预成型焊片，在使用方式上更加灵活多样，适用于微型光电器件的高可靠性封装及大功率器件的高导热封装。





重点展示光电子芯片

展示范围：光芯片、电芯片、VCSEL / 激光芯片、传感器芯片

光芯片

芯思杰技术（深圳）股份有限公司

11A53

25Gbps/50Gbps APD芯片

该25Gbps/50Gbps APD光探测器芯片是GSG电极结构，为正面入光的高速雪崩光探测器芯片，光敏区尺寸分别是 $\Phi 16\mu\text{m}$ / $\Phi 12\mu\text{m}$ 。产品的主要特点是高倍增、低电容、低温度系数和高可靠性，主要用于25G PON、50G PON、5G无线和100G ER4。



陕西源杰半导体科技股份有限公司

12B51

10G&25G CWDM6 DFB Laser

应用于5G前传，面对5G前传高速率、大容量、省光纤的应用场景，该系列芯片源杰2020年国内发货量位居榜首，大批量交付给多个业内领先的光模块和系统设备厂家。



苏州熹联光芯微电子科技有限公司

11A28

800G 2XFR4 硅光 PIC

6.5mm x 6.0mm silicon photonics (SiPho) transmitter chip. Mach-Zehnder modulator designed with on-chip matched termination resistance. Thermal phase tuning sections and power monitors for MZI phase bias control. Integrated CWDM multiplexer.



镁可微波技术（上海）有限公司

11B61

200G PIN PD

MARP-BP112是一款200Gbps PIN PD，是MACOM最新推出的光电探测器产品。它采用集成透镜的背照式设计，提高了对准误差，并可进行倒装芯片粘接。



光芯片

桂林光隆科技集团股份有限公司

11A15

探测器芯片

芯隆科技产品应用于光通信 (PON网络 / 数据中心) 和传感器 (气体检测 / 温度监控) 两大类领域, 同时具备接收端芯片和封装的客制化设计和量产能力。主要产品类为光通讯探测器芯片和TO器件: MPD / 2.5G PIN PD / 2.5G APD; 10G PIN PD / 10G APD / 25G PIN PD; 气体传感器接收端芯片: 1653.7nm光敏面1000 μ m PIN PD。



MPD 芯片



2.5G PIN PD

实光半导体

11C61

增益芯片

实光半导体DenseLight 的增益芯片在C波段、L波段和O波段波长范围内提供高光学增益。增益芯片作为外腔激光系统中的激光增益源, 以芯片形式安装在基座上。增益芯片在一个端面上具有高反射率(HR)或低反射率(LR)涂层, 在另一倾斜端面上具有抗反射(AR)涂层。我们能够为硅光子平台或其他光学平台定制倒装增益芯片, 并提供进一步的输出模式和输出涂层优化, 以实现最大耦合效率。这些定制设计和优化提高了光子系统的集成度, 帮助客户实现高功率、窄线宽和低成本的外腔激光器。



众瑞速联 (武汉) 科技有限公司

12A28

400G/800G系列硅光芯片

Hyper Photonix 400G/800G硅光芯片基于其自研量产级硅光工艺平台制造, 能够提供35GHz以上调制带宽, 4.5 dB以上消光比, 兼容市面主流硅光驱动芯片, 能够为400G DR4及800G DR8发射端应用提供优异的性能保障。其低损耗Edge-Coupler支持光源空间光与光纤阵列直接耦合两种方式, 支持非气密封装, 芯片尺寸及管脚定义易于实现QSFP-DD/OSFP及COBO主流模块封装。

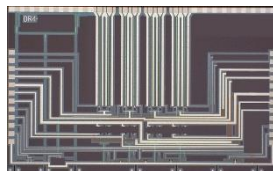


宏芯科技 (泉州) 有限公司

12C73

400G FR4 硅光芯片

400G FR4 硅光芯片; 速率: 4 $\times$ 100 Gbps PAM4; 工作波长: 1271/1291/1311/1331 nm; 单通道插损: <5.5 dB; 电光带宽: >38 GHz; 差分阻抗: 60 ohms; 差分驱动电压: 3.5 Vppd; 消光比: >4.5 dB; 工作温度: 0~70 $^{\circ}$ C。



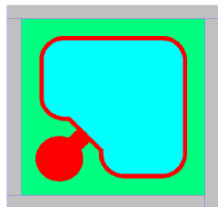
光芯片

河北光森电子科技有限公司

12E51

高速光探测器芯片

1.25-200Gbps InGaAs PIN 高速光探测器芯片及阵列； 2.5-25Gbps InGaAs 雪崩光电二极管（APD）芯片； InGaAs PIN 大面积光探测器芯片； 1.25-200Gbps GaAs PIN 高速光探测器芯片及阵列。



上海羲禾科技有限公司

12D917、12D918

800G DR8 发射芯片

DR8 Tx产品是带有8路53Gbaud调制器的硅集成光子芯片，可应用于数据中心。

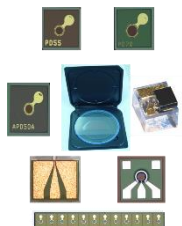


中电科芯片技术（集团）

12D31-2

光通信用探测器芯片、激光器芯片及器件模组等

拥有完整的半导体光电探测器/激光器芯片生产线，产品包含2.5G/10G DFB、2.5G/10G/25G APD、25G/4*25G PD等多类光收发芯片，及TO、OSA封装生产线，是国内光通信领域的主流供应商。

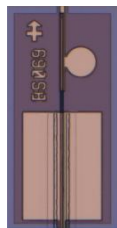


苏州鼎芯光电科技有限公司

11E55

EML 10G 1577nm/DWDM chip

此款产品采用多量子阱有源层，并单片集成EA 调制器及DFB激光器。工作温度为45C~55C，主要用于XGSPON OLT；EML 10G TDM/DWDM Chip。此款产品采用掩埋异质结结构，兼顾高可靠性和高性能的需求，同时拥有低阈值，高出光效率，高边模抑制比以及高良率低成本的优势。为保证实际网络传输中信号的可靠度，此款芯片产品通过全套Telcordia GR-468标准的检验，并在所有芯片出货前均经历严格的Certification流程，以确保产品的高可靠性。



光芯片

上海新微半导体有限公司

12C61

25G PD芯片

新微半导体已完成基于平面结与台面结的3/4吋光电探测器的全工艺开发，运用MOCVD设备生长外延片和Zn扩散，晶圆制造工艺包括Stepper曝光、E-Gun/sputter金属工艺、自动腐蚀/清洗、BCB、ICP干法/湿法刻蚀、减薄、划裂等工艺技术，产品可应用于光纤通信、近红外成像、激光雷达等市场。



滨松光子学商贸（中国）有限公司

12C63

高速InGaAs PD芯片

针对目前5G和数通的25G到400G光模块，滨松可以提供全系列正照式和背照式，单点和阵列，裸片和COC InGaAs PIN PD产品。



武汉云岭光电股份有限公司

12T32

EML 25G
1310/1358nm/LWDM chip

EML 25G 1358nm Chip，在20°C~60°C工作温度下运行速率高达28G，脊波导结构，具有多量子阱n型衬底有源层和光栅，低阈值电流，用于以太网、数据中心等。28G LWDM Chip，波长覆盖1295.56/1300.05/1304.58/ 1309.14 nm，在LWDM最高运行速率可达28G，脊波导结构，具有多量子阱n型衬底有源层和光栅，低阈值电流，工作温度范围为20°C至60°C，符合RoHS标准，符合Telcordia GR-468标准，用于光纤以太网等。



浙江光特科技有限公司

11C908

InGaAs Φ 80 μ m Analog PD Chip/
InGaAs 200 μ m MPD Chip

InGaAs Φ 80 μ m Analog PD Chip主要应用于数字以及模拟光通信、模拟有线电视。InGaAs 200 μ m MPD Chip 用于光功率监测的InGaAs 光电探测器。



电芯片

深圳市富泰克光电有限公司

12A11、12A21

5nm 400G/800G
数字信号处理芯片

Keystone是具有高集成度的PAM4 DSP SoC, 可实现 800Gbps光学单波 100G传输, 光/电接口均支持 106.25Gbps PAM4 信令适用于DR、FR 和 LR 应用。该器件支持丰富的数字信号处理功能, 包括线路侧 Tx数字预失真 (DPD)、发射预加重 (Tx FIR)、接收前馈均衡 (Rx FFE) 和决策 反馈均衡 (DFE)。采用 12mm × 13mm 封装, 集成EML 驱动器, 差分摆幅可达4.0Vpp 可直驱硅光(SiPh)和电吸收调制激光器 (EML), 为 112G信号提供出色的信号完整性, 适用于下一代QSFP-DD800和OSFP等封装尺寸, 也支持裸die应用于CPO等场景。

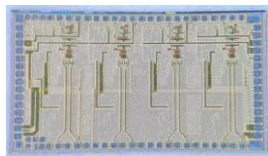


杭州芯耘光电科技有限公司

11B21

XY5351/4 & XY53A1/4
线性跨阻放大器

XY5351/4 & XY53A1/4 线性跨阻放大器是覆盖50G~400G应用的高灵敏度、低噪声和高带宽一、四通道线性TIA。它专为 26~53Gb/s PAM4符号率而设计。该芯片提供从 250Ω 到5kΩ可调差分跨阻。带宽可以调整和在噪声和 ISI 之间进行权衡优化接收灵敏度配置。这些TIA 提供反向偏置电压和光电流监视器(RSSI)用于 PIN 光电二极管应用。



芯境科技（上海）有限公司

11C21

光模块DSP芯片

Credo的低功耗、高性能DSP产品拥有业界领先的传输性能, 能够为云规模、超大规模和企业级数据中心, 以及5G基础设施部署中的50G-400G PAM4光模块提供光互连, 功耗及价格极具市场竞争力。产品采用Credo专有的DSP技术和均衡技术有助于补偿光学损伤, 以实现最佳的整体系统性能、信号完整性和低功率。Credo光DSP现有单通道100G的Dove和单通道50G的Seagull两个产品系列。其中Seagull全系列可选配支持工温, 且已推出集成VCSEL/EML Driver的产品。

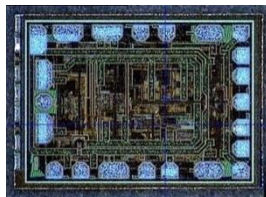


上海米硅科技有限公司

12D33

ms52000 -应用于XGS PON的
10G 突发跨阻放大器

ms52000是高灵敏度突发跨阻放大器, 满足XGS PON 2.5G和10G网络所需要的恢复时间和突发动态范围, 支持快速自动增益控制和快速信号探测功能。



电芯片

厦门优迅高速芯片有限公司

11C33

100G SR4 收发方案:
UX2291+UX2091

UX2091是一种四通道高灵敏度限幅TIA，带有为100G/200G可插拔光模块所设计的CDR。UX2291是一个四通道 25.78Gbps的VCSEL激光驱动器，集成了CDR和输入均衡器。每个通道由一个输入均衡器、一个激光驱动器和一个高性能的CDR组成。UX6001/UX6002是32位光通信用的微控制器，可以与100G SR4收发方案搭配使用。

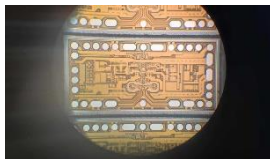


江苏科大亨芯半导体技术有限公司

11C72

100G PAM4跨组放大器

HX3050是一款基于PAM4调制技术的高性能线性跨阻放大器，可以支持56Gbaud的传输速率，内部集成了峰值检波器、自动增益控制电路以及平均光电流监控电路（RSSI）。



鹏瞰科技（上海）有限公司

11E53

VN1802 GPON OLT 芯片

VN1802是一款高度集成的单芯片、高性能PON OLT SoC，支持GPON，为FTTR应用提供功能丰富且经济高效的解决方案。VN1802集成了标准PON MAC、网络交换引擎（NSE）、SoC子系统和NNII以太网端口，支持HSGMII（2.5G）和10Gbps XFI、KR和USXGMII接口，以及许多其他常见的外围接口。VN1802是业界第一款可用于FTTR应用的ASIC方案，相比FPGA方案其低功耗、低成本、高性能、高可靠等特性使得FTTR真正迈入可商用和可大规模推广。

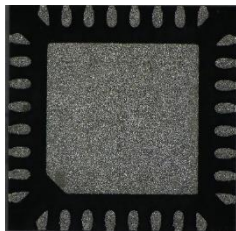
光
电
子
芯
片

厦门亿芯源半导体科技有限公司

12D52

EOC5006-S

集成了限幅放大器(LA)、激光驱动器(LDD)和数字诊断功能(DDM)，最大偏置电流120mA，最大调制电流92mApp，集成自动功率控制环路，可编程 TX眼图调整和输入均衡，上升下降时间可编程；RX输入灵敏度5mVppd（14Gbps），信号丢失阈值可调整，RX输出摆幅可编程。



电芯片

功芯科技（广州）有限公司

12A91

Coherent Driver and TIA

相干光通信用driver和TIA芯片组，传输速率覆盖64G~128GBaud。芯片具有带宽高，功耗低，增益大，支持倒装焊封装，具有SPI和模拟两种控制接口等特点。driver芯片差分输出幅度高达4Vpp，可调增益范围大，内置peaking detector。TIA芯片输入噪声电流低，AGC输出幅度可调，具有AGC和MCG模式。

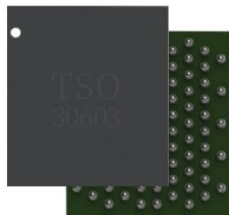


成都明夷电子科技有限公司

12C26

TSO30603&TSO40603

4*25 DML Driver/CDR+TIA for 100G LR4/CWDM4 应用于5G中回传&数据中心应用领域。集成了自适应输入均衡、无参考时钟CDR、DML激光驱动器、DDM控制及PRBS测试电路。CDR输入范围22.5Gbps到28.1Gbps，具有高输入抖动容限低输出抖动特性。激光驱动器最大IBIAS和IMOD电流分别为70mA和76mA。



成都英思嘉半导体技术有限公司

12A61

ISG-C2925 25G CDR+EML+BM LA

英思嘉ISG-C2925是业界首款25G CDR + EML Dr. + BM LA Combo Chip产品，旨在满足新一代25G PON OLT的应用需求，适用于25G对称和50G非对称应用。该产品发端配有CDR和EML驱动器，收端配有支持突发模式的25Gbps限幅放大器。发端实现了输入均衡可调、LOS功能和EML驱动器眼图调节功能。收端的突发模式限幅放大器具有EQ可调和去预加重功能，同时提供高速SD/LOS功能且检测阈值可调。封装规格为4.5x4.5mm，小巧紧凑便于设计应用。

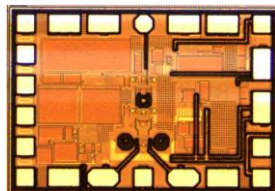


深圳市微科光电子有限公司

12A75

53Gbaud Linear TIA Amplifier

AL2510D_53G is a high sensitivity 53Gbaud linear trans-impedance amplifier (TIA) suitable for 100Gbs/200Gbs/400Gbs Ethernet PMD with PAM-4 modulation format.



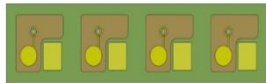
VCSEL / 激光芯片

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

12D16

50G PAM4 VCSEL

50G PAM4 VCSEL, 工作波长850nm, 1 single、1*2、1*4 array 多种封装形态, 支撑数据中心100G/200G/400G 短距应用场景。

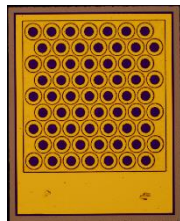


江西德瑞光电技术有限责任公司

4C052

905nm 多结VCSEL芯片

905nm多结VCSEL阵列设计, 多通道可实现分区点亮。与单结VCSEL对比, 多结VCSEL将多个PN偏置结在垂直方向上串联, 输出更高的峰值功率, 并获得更佳的信噪比, 驱动电流更小, 大幅度降低系统的功耗。在同样光功率下, 能减小芯片制造尺寸, 多结VCSEL阵列芯片将是激光雷达光源的发展最佳路线。

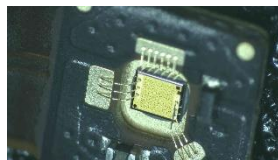


徐州仟目科技集团有限公司

12C53

940nm多分区VCSEL

940nm VCSEL 系列产品, 独立自主研发的高功率、高效率光学设计, 具有高可靠性, 波长稳定, 光谱宽度窄, 热阻低, 高可靠性表现卓越等特点。可广泛应用于三维传感、激光雷达、泵浦、安防、医疗、红外照明、3D人脸识别、辅助驾驶等领域。

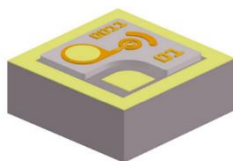


浙江老鹰半导体技术有限公司

12A52

50G PAM4 VCSEL芯片

850nm多模垂直腔面发射激光, 拥有高可靠性、高一致性、低噪音、低阈值和工作电流等特点。该款产品主要应用到数据中心领域 50G\100G\200G光模块, 支持以太网与云存储数据交换。



VCSEL / 激光芯片

Lumentum Operations, LLC

6B57

M 系列：适合多场景应用的多结 VCSEL 阵列

Lumentum M 系列 VCSEL 产品可以提供汽车以及工业激光雷达和 3D 传感应用所需的功率和可靠性。M 系列秉承特有的创新性和灵活性，利用 Lumentum 出色的多结 VCSEL 技术，在各种外形尺寸的产品中实现业界领先的功率密度，可将产品快速集成到 3D 传感解决方案中。VCSEL 因其固有的可靠性、效率和灵活性而成为汽车和工业应用的理想之选。M 系列已经通过 AEC-Q102 认证，可以快速方便地应用在 3D 传感解决方案中并实现规模化。



无锡神州高芯科技有限公司

11C75

**10G/25G/40G/100G
850nm VCSEL**

单通道产品满足工业级要求，高可靠性，一致性，低噪声。主要应用于以太网光模块，AOC等应用场景。



广州市鸿利秉一光电科技有限公司

8C37

垂直腔面激光器 (VCSEL)

技术领先：全球领先芯片供应商。全无机封装技术：封装材料100%不使用有机材料。避免强红外辐射对有机材料造成的黄化问题、热应力及湿应力导致的失效问题。气密性封装：达到美军标MIL-STD-883的要求。惰性气氛保护：99.999%的氮气保护。应用于：生发、润肤、感测等。

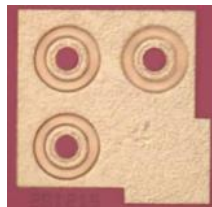


赣州沃泰芯半导体科技有限公司

6A30

VCSEL芯片 -PS系列

小功率VCSEL 芯片，可用于接近式传感器领域，替代传统的LED光源。关键指标，功率：5-100mW 波长：850、940nm 电光转换效率：>45% 高效率 产品特性，长寿命、高可靠性、可定制。应用领域，短距离传感、3D 传感、生物医学等。



VCSEL / 激光芯片

通快（中国）有限公司

6C39

940nm 2D VCSEL
array - LiDAR

新一代单片式底部发光集成光学VCSEL。作为新一代的VCSEL产品，是基于通快高性能VCSEL技术，在砷化镓基底表面直接蚀刻出独特的，具有专利的光学器件。由于微光学器件整体集成在ViBO芯片上，3D传感解决方案供应商可以利用此技术创建先进的3D传感应用所需的定制化照明方案，从而获得前所未有的受益。此外，ViBO的创新设计可以把器件做的比现有的组合封装更小，并且更易于整合到手机屏幕的方案中。该技术适用于各种接近传感：从智能眼镜到人脸识别以及LiDAR等应用。



浙江睿熙科技有限公司

6C36

车载VCSEL芯片及多结VCSEL芯片

睿熙科技车载产品涵盖智能座舱和智能驾驶完整产品布局。睿熙科技多PN结的VCSEL激光器，优点是发光效率比较高，斜率效率更高，可大幅降低所需的电流，进而提高了驱动器的切换速度。多结VCSEL虽然性能突出，但其多个PN结之间的连通难度也比较高，我司多结产品多样，性能优异。



深圳瑞识智能科技有限公司

6C35

VCSEL光芯片

瑞识VCSEL芯片产品矩阵种类齐全，涵盖了单孔或多孔芯片，规则或随机发光孔阵列芯片，单结或多结芯片，可寻址芯片。光功率从毫瓦级低光功率（连续驱动）至数百瓦级的高光功率（脉冲驱动），波长范围包含红光可见光（650nm-680nm）和近红外光（808nm、850nm、905nm、940nm）。瑞识VCSEL芯片产品可广泛应用于诸如接近传感、3D ToF/结构光、激光雷达、人脸识别、机器视觉、安防监控、医疗美容等应用领域，并可根据客户特定需求快速定制开发芯片。

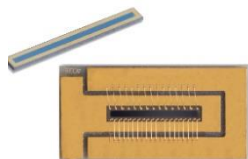


深圳市柠檬光子科技有限公司

6C01

HCSEL水平腔面发射
半导体激光芯片

HCSEL芯片波长940nm，976nm。功率：2W，8W，30W。水平谐振，垂直出光特点原理，是天然的线激光源。柠檬光子的HCSEL单芯片尺寸可以在小于1mm ~ 10mm定制。HCSEL大功率、高可靠性，又能做到低成本。同时拥有大的出光面积和高质量的光束，达到大功率、高亮度、光束均匀的激光特征，非常适于长距离，高精度激光雷达应用；另外由于大的出光面积，出光面功率密度变低，器件的寿命也会相应变长；HCSEL的激光芯片结构及出光方式还可以降低芯片成本，方便和模组内其它光学器件集成。



传感器芯片

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

6A52

激光雷达VLR芯片

长光华芯拥有完整VCSEL 6寸线工艺平台和量产产线，包含芯片设计、外延生长、台面刻蚀、氧化工艺、电镀金、性能测试等，长光华芯凭借在MOVCD 外延技术、氧化孔径精确控制和外延流片工艺等方面的深厚积累，VCSEL芯片的设计、外延和流片完全自主可控。长光华芯拥有飞行时间VLR系列产品，性能指标先进，已向市场批量供应。



杭州宇称电子技术有限公司

6B37

SiPM高精度多通道信号处理ASIC芯片--MPT2321

MPT2321-B专门针对基于SiPM器件的dToF激光雷达应用，提供高集成度、高精度和低功耗的后端信号采集、处理与深度计算一站式方案。MPT2321-B直接读取SiPM输出信号，在单芯片内完成32路独立信号的放大、整形、滤波采样和信号处理，直接输出能量和目标距离信息。可适配于各种SiPM单点与阵列芯片。



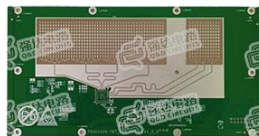
光电子芯片

深圳市强达电路股份有限公司

6B30

77G毫米波雷达板

材料：mmWave77-H3+FR4
线宽线距：4/4mil
最小孔径：0.2mm
板厚：2.0mm
工艺：局部薄铜+激光盲孔



福州熠和微电子有限公司

6A91

高性能5000万像素SoC-FIC7639

FIC7639为高性能高分辨率相机设计的ISP芯片，广泛应用于智能电视、交互大屏幕、视频会议、文档扫描、工业相机、机器视觉和医疗成像等应用。该芯片内置异构处理器，包括MCU和DSP；采用第二代ISP处理器，支持MIPI/LVDS/DVP接口；支持双Sensor输入，支持拼接和画中画；ISP最高输入像素为5000万；支持2D和3D降噪等，支持PDAF相位聚焦等；针对影像细节和色彩增强，提供优异画质；内置音频IIS和Audio ADC；支持USB2.0/DVP/MIPI TX/SDIO等输出接口。



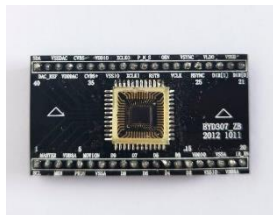
传感器芯片

长春理工大学

6C106

FPX1002高清CMOS
图像传感器芯片

FPX1002是市场上第一款1/5英寸、分辨率为1280x720的100万高清CMOS图像传感器芯片产品,采用先进的110nm CMOS工艺,集感光、光电转换、模数转换、数字图像处理等功能。

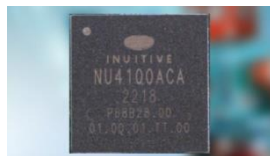


银牛微电子(无锡)有限责任公司

6D69

银牛自研系列芯片

银牛自研系列芯片内含丰富的3D感知和视觉图像处理引擎,算法芯片化能够提供深度3D感知成像、AI目标识别和SLAM目标跟踪以及计算机视觉算法加速等图像处理功能。芯片架构对性能和功耗进行平衡设计,提供强大3D图像处理功能的同时可实现单独内置的电源管理和时钟控制。

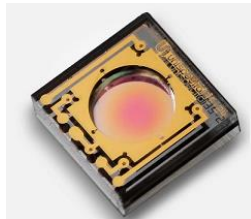


优尼科(青岛)微电子有限公司

6D25

ColorIR™近红外可调谐滤波芯片

ColorIR™ - Unispectral公司开发的低成本近红外多光谱成像芯片,可以捕获单光谱近红外图像。通过修改法布里-珀罗干涉腔位置(即光学间隙)可以选择其拍摄照片波长。它可以集成进微型红外光谱相机[消费电子、专业设备、移动设备],通过多光谱成像功能将红外相机升级为具有物质识别鉴权功能的设备。



中科传感(佛山)科技有限公司

6D152

高精度薄膜型MEMS智能测温芯片

MEMS智能测温芯片是利用半导体工艺将薄膜NTC电阻和IC电路集成为一个有机的整体,带有微处理器,具有高精度的信息自动采集、处理、无线传输交换信息的能力,可直接数字输出测量的温度值。





重点展示传感器

展示范围：MEMS传感器、3D视觉/图像传感器、
工业传感器、各类传感器



MEMS传感器

深圳市美思先端电子有限公司

8E08

精小型冷媒传感器

美思先端精小型冷媒传感器采用NDIR非分红外吸收原理, 结合高精度采样电路, 内置气压、温度补偿和自校准功能, 能够对环境中的各类制冷剂气体浓度进行实时在线监测, 可广泛应用于商用空调、中央空调、制冷机组等产品制冷剂泄露检测, 为用户生命财产安全保驾护航。产品特点: 测量精度高; 响应速度快 性能稳定可靠; 内置气压、温度补偿。

MFrontier 美思先端

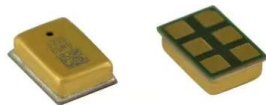


楼氏电子（上海）有限公司

6A37

Knowles 楼氏电子首款数字骨传导麦克风-V2S200D

V2S200D体积小、信噪比（SNR）高、功耗低, 对于那些希望提升产品用户体验, 同时解决重要工业设计（ID）和电池寿命限制问题的OEM/ODM, 它提供了理想的解决方案。此外, 在集成到系统中后, 它可仿真具有脉冲密度调制（PDM）接口的数字麦克风, 使硬件和软件开发变得轻松自如。



V2S200D

SNR / 64.5 dBA
3.30 mm x 2.30 mm x 0.93 mm
Current: As low as 290uA
4KHz

深圳市英唐极光微技术有限公司

6D46、6D47

二维电磁驱动型MEMS Mirror

二维电磁驱动型MEMS Mirror, 其中4mmφ规格准备进入试产, 8mmφ规格正在开发中。该产品具有体积小、低功耗、宽广的FOV等特点。低串扰（两轴独立驱动）, 内置角度和温度传感器（压电传感器）经验证该产品寿命长, 可靠性高。已成功通过汽车可靠性测试。



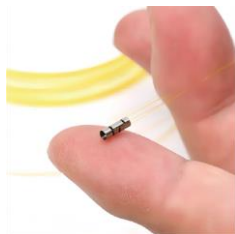
CG0006AR (4mmφ)

北京佰为深科技发展有限公司

6D26、6D27

JR-1400G法珀腔医用（接触力）传感器

JR-1400G光纤力传感器, 基于光纤和MEMS技术, 通过传统的后端复合力向前端的多维力测量变革, 实现力的精准感知, 同时兼顾安全、抗菌、抗干扰能力, 适用于血管或腔道接触力、挤压力监测和机器人力反馈。



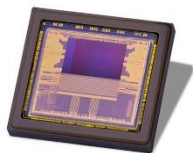
3D视觉/图像传感器

特励达易图威科技（北京）有限公司

6A31

Hydra3D飞行时间测距 (ToF)
CMOS图像传感器

Hydra3D 是一款 832 x 600 像素 飞行时间测距 (ToF) CMOS 图像传感器，设计采用 Teledyne e2v 的专有 CMOS 技术，打造出新一代 3D 视觉系统。Hydra3D 包括 10μm 三内存节点先进像素技术，可为追求高水平 3D 成像性能（包括高精度分辨率、高速和灵活操作条件）的客户实现高速传输。

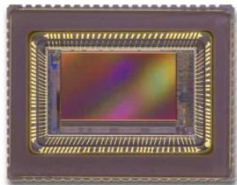


长春长光辰芯光电技术有限公司

6B31

GMAX4002 4微米 2.4MP
高速全局快门CMOS图像传感器

GMAX4002采用先进的4μm电荷域全局快门像素以及1/1.7"光学尺寸，有效分辨率为2048(H) x 1200(V)。可被广泛应用于机器视觉、工业检测、运动捕捉、3D成像等领域。GMAX4002提供普速和高速两种版本。



锐芯微电子股份有限公司

6C22、6C23

CMOS ECCD-TDI
图像传感器及模组

CMOS-ECCD技术兼具CCD TDI传感器的高灵敏度、高信噪比和 CMOS TDI传感器的高速度、低功耗、系统简化的优点，代表业界最先进的技术。Venus系列提供多种不同分辨率机型，可实现最多256级双向积分，满足各种工业使用环境的需求。



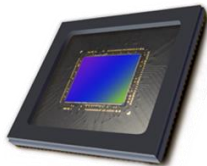
传
感
器

思特威（上海）电子科技股份有限公司

6A31

思特威旗舰级智能手机主摄应用
图像传感器SC550XS

思特威旗舰级智能手机主摄CMOS图像传感器SC550XS，采用先进的22nm HKMG Stack工艺制程，具有5000万超高分辨率1.0μm像素尺寸，搭载思特威SmartClarity®-2成像技术，以及SFCPixel®与PixGain HDR®专利技术，拥有出色的成像性能。此外通过AllPix ADAF®技术加持可实现100%全像素对焦，并配备了MIPI C-PHY 3.0Gbps高速数据传输接口。SC550XS在夜视全彩成像、高动态范围以及低功耗性能上均可满足旗舰级智能手机主摄的需求。



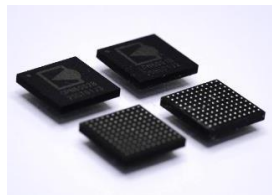
3D视觉/图像传感器

上海炬佑智能科技有限公司

6C69

3D ToF(ToF Sensor & ISP)

ToF Sensor是ToF系统Rx部分的核心组成, 炬佑提供多种规格的Sensor芯片, 满足不同应用需求。ISP芯片接收ToF sensor产生的raw数据, 借助片上低功耗高性能计算引擎实时计算出深度等信息。相较于传统借助外置算力进行深度解算的方案, 炬佑ISP芯片简化了ToF深度运算, 大大降低用户开发难度。同时, ISP芯片内置了Cortex-M3的ARM核, 提供了实现客户定制化算法的灵活性。

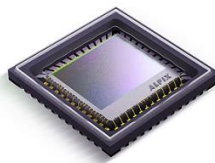


北京锐思智芯科技有限公司

6C45

超低功耗融合式视觉传感器
ALPIX-Titlis™

ALPIX-Titlis™ 是一款将传统图像传感器 (CIS) 与事件传感器 (EVS) 在像素层面融合至同一颗芯片的新型视觉传感器, 可切换输出高质量图像信号和事件流信号。EVS事件模式产生数据量小、功耗低, 能够满足隐私保护需求, 可配合高质量的CIS图像, 满足安防、AIoT场景中的多种需求。ALPIX-Titlis™ 可广泛应用于安防、AIoT、汽车、消费电子、工业、医疗等场景。



深圳北极芯微电子有限公司

6D62

DTS6007M

DTS6007M是一款单通道dToF (直接飞行时间) SiP微型模组, 集成了北极芯微研制的高性能dToF SoC以及VCSEL发射器, 能够实现5m范围内的高精度距离测量, 帧率可达120Hz。DTS6007M基于高性能SPAD传感器, 片内集成高精度TDC和协处理器, 可以高效地进行距离测量。DTS6007M内置直方图算法, 从而具备出色的抗环境光能力, 并且能够对污染物和反射率进行校准。DTS6007M采用940nm激光, 符合1类人眼安全要求。采用单电源供电, 并基于I2C接口进行数据通信, 易于集成和使用。

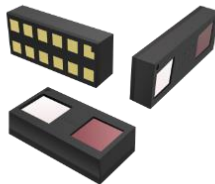


光微信息科技(合肥)有限公司

6C49

4m多区TOF测距传感器ND07

ND07 是一款微型多区高集成度TOF 测距传感器, 其支持24个区域 (6*4) 同步测距, 测距范围可达4m, 具有精度高、尺寸小、测距稳定等特点。适用于智能家居、投影仪、机器人、智能卫浴等应用场景。



工业传感器

深圳万悟创新电子有限公司

6E51

甲烷/天然气/煤气/液化石油气
泄露监测传感器

烷烃类气体传感器U9303系列可用于液化石油气/天然气/煤气泄露监测。该传感器采用专利的光学设计、电路设计、数字信号处理算法和补偿算法，此外，产品通过了多项严苛的环境测试，可靠性高。相较于催化燃烧式/电化学可燃气体传感器，NDIR气体传感器具有精度更高、寿命更长、稳定性更好的特点。此外，NDIR气体传感器是利用光学原理来实现探测的，相较于催化燃烧式/电化学可燃气体传感器，NDIR传感器不容易受到其他种类气体的干扰，从而导致中毒或误报警。可根据客户提供具有价格竞争力的低成本批量定制方案。

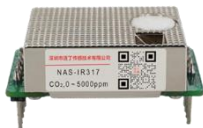


深圳市连丁传感技术有限公司

6E31

红外二氧化碳传感器
NAS-IR317

NAS-IR317红外气体传感器用于检测二氧化碳气体，采用红外传感自主专利技术和智能数据处理算法，稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命长。具有自主校零，温度补偿等功能，适用于新风系统、中央空调、空气净化器等使用场景。采用最新算法，包含二氧化碳浓度算法、自主校零算法，温度补偿算法等，采用工业级微处理器，在不同的工作环境中都能提供较快的运算速度，输出结果精度高，稳定性好。



深圳市信为科技发展有限公司

6D41

磁致伸缩位移传感器

磁致伸缩位移传感器是利用磁致伸缩原理开发的高精度位移测量传感器。采用非接触测量方式、产品使用寿命长，环境适应性强；不需要定期标定和维护；产品为绝对量输出，重启无需归零；具有高精度、高稳定性、高可靠性、高重复性的技术特点；输出支持电流、电压、SSI、Modbus、PROFIBUS等多种输出方式，广泛应用于石油、钢铁、化工、港口、机械和食品等环境恶劣的工业场合，是高精度位移控制的首选。



深圳市通瑞科技有限公司

6D29

电容式角度传感器

电容式角度传感器主要以电编码器专利技术为基础，提出了一个独特和创造性的方法来检测位置，其小型高精度、耐低/高温、真空环境、抗高振动/冲击、低电磁干扰/电磁辐射等特点，已远远超越普通的光电编码器和旋转变压器技术，其独特的优越性已在航空航天、医疗设备、汽车、电子通信等各种应用中展示。



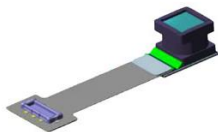
传感器

嘉兴驭光光电科技有限公司

6D61

投射器模组

RLP-ALKAID5000 是一款配备先进结构DOE光学元件的红外激光随机散斑投射器，主要应用于3D感知领域。该投射器配备FPC引线及连接器，支持可插拔电气连接，方便客户使用。该产品效率高、成本低、使用灵活，可支持3D结构光和双目立体视觉系统应用。



中国科学院空天信息创新研究院

4C080

微型静电传感器及监测系统

静电是引起油气火灾、电子元件失效等重大事故的关键因素之一。静电监测在航天发射、石油石化、工业生产、集成电路等多个领域具有重要意义。传统静电防护措施只能消除静电或避免静电产生，无法对防护效果进行评估。静电监测系统通过收集多点位静电传感器测量数据，可以做到实时监控各静电敏感点位的静电电压测试、报警情况，及时提醒安防或ESD维护人员采取有效措施消除静电隐患，并对静电消除情况进行有效评估。同时还拥有操作记录、数据存储、数据查询、多用户管理等功能，便于后续对各监测点位静电产生过程的数据分析与工艺优化。

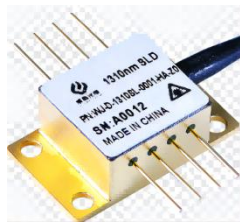


汉威科技集团股份有限公司

6A06

光纤陀螺仪传感器

- 1、1310nm；
- 2、单模、低偏振、宽光谱、低纹波；
- 3、8PIN/6PIN蝶形封装、特殊封装可定制；
- 4、用于光纤陀螺仪，光纤传感等领域。



巴斯夫（中国）有限公司

6A23

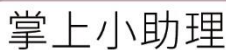
光谱个人应用消费类

创迈思光谱技术基于可直接内置于智能手机中的独特传感器模块，最终允许消费者通过将智能手机接触在皮肤上来实现个人测量。通过近红外(NIR)光谱和智能算法，该传感器可以测量所谓的生物标志物，反应一个人的健康状况的不同方面。用户从而可以根据自己的测量实时接收量身定制的建议。



传感器

*以上所有企业产品及展位号以现场为准。



找展商 查产品
搜会议 看直播



扫码并添加至“我的小程序”

方便随时查看使用

